socionext™
The Solution SoC Company

2026年度 第1四半期

決算概要

2026年7月29日
株式会社ソシオネクスト

免責事項

本資料は、株式会社ソシオネクスト（以下「当社」といいます。）に関する一定の情報を提供することのみを目的として作成されたものです。本資料は、当社普通株式その他の有価証券の売買を勧誘または申し込みを行うものではありません。本資料及びその記載内容は、当社の書面による事前の同意なく、全部または一部を問わず、第三者により複製、転載または再配布されることはできません。
本資料に記載された情報は、本資料作成日現在の経済状況、市場環境、規制その他の条件に基づいています。当社およびそのアドバイザーまたは関係者は、本資料に含まれる情報の正確性、完全性または妥当性について、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行うものではありません。将来の状況の変化により、本資料に記載された情報が影響を受ける可能性があります。したがって、本資料に記載された情報は、事前の通知なく重要な変更が行われることがあります。
本資料には、予測、見通し、目標および計画など、将来に関する記述が含まれている場合があります。これらの将来に関する記述は、当社経営陣による将来業績を保証するものではありません。また、これらの記述は、本資料作成時点における当社の前提および仮定に基づくものであり、既知および未知のリスク、不確実性その他の要因の影響により、実際の業績、結果または達成状況が、これらの記述に明示または黙示されている内容と大きく異なる可能性があります。
本資料において別途明示されていない限り、本資料に記載された見解、記述および見通しは当社のものであり、第三者により提供または作成された情報については、公開情報その他引用された情報源に基づくもので、当社はその正確性または妥当性について独自の検証を行っていません。

Copyright 2026 Socionext Inc.

商談獲得金額及び商談獲得残高に関する注意事項

商談獲得金額および商談獲得残高の算出には、将来に関する見積りおよび主観的判断が相当含まれています。これらの算出は、開発計画、開発コスト、NRE売上、製品単価、将来の製品販売数量に関する見込みに加え、個々の製品の想定販売期間および中止となる可能性に関する見込み等の前提に基づいています。
製品の販売数量は、顧客から提示された初期的な数量見込みに加え、顧客との過去の取引実績、第三者による市場データその他の要因を織り込んだ当社独自の予測に基づき算定していますが、製造委託先における製造キャパシティの制約などは十分に考慮していません。
売上高の分析および商談獲得残高の算定にあたっては、当社は、顧客需要が「特需」に該当するかどうかを評価しています。「特需」とは、在庫の積み増しなど、市場の本源的な需要を反映しない活動に起因する短期的な需要を指します。
当社は、当該需要に関連するさまざまな要因を考慮したうえで、各案件について当社の判断により、当該需要が特需に該当するかどうかを個別に決定しています。その結果、特需として識別された金額は、この定義に照らして必ずしも客観的に正確であるとは限りません。
当社は、商談獲得残高を長期的な売上動向を評価・分析するための指標として位置付けていることから、このような短期的な特需は商談獲得残高から除外することが適切であると考えています。特需に起因する売上高は、長期的な需要の前倒しにより短期的に膨らんだ需要とみるべきものであり、過去および将来の業績動向を分析するにあたっては、重視すべきではないと考えています。商談獲得残高は、特需の発生有無やその金額の大小には影響されない一方で、特需を除く需要に関する予測前提の変化を反映して変動する可能性があります。
当社は、過去にも行ってきたとおり、将来、商談獲得金額および商談獲得残高の算出方法を変更する可能性があります。そのため、期間ごとの単純な比較は、長期的なトレンドを把握する目的を除き、必ずしも有意ではない場合があります。
商談獲得に関する情報は、管理会計ベースで算出され、経営陣が業績評価および戦略・計画立案を行うために内部的に作成・利用されているものです。商談獲得に関する情報は参考情報として提供されるものであり、これに過度に依拠すべきではありません。将来予測に関する一定のリスクについては、本資料2ページをご参照ください。

Copyright 2026 Socionext Inc.

socionext™
The Solution SoC Company

2026年度第1四半期 連結決算

- 2026年度第1四半期 連結決算概要
- 2026年度通期 予想

2026年度第1四半期　連結損益計算書

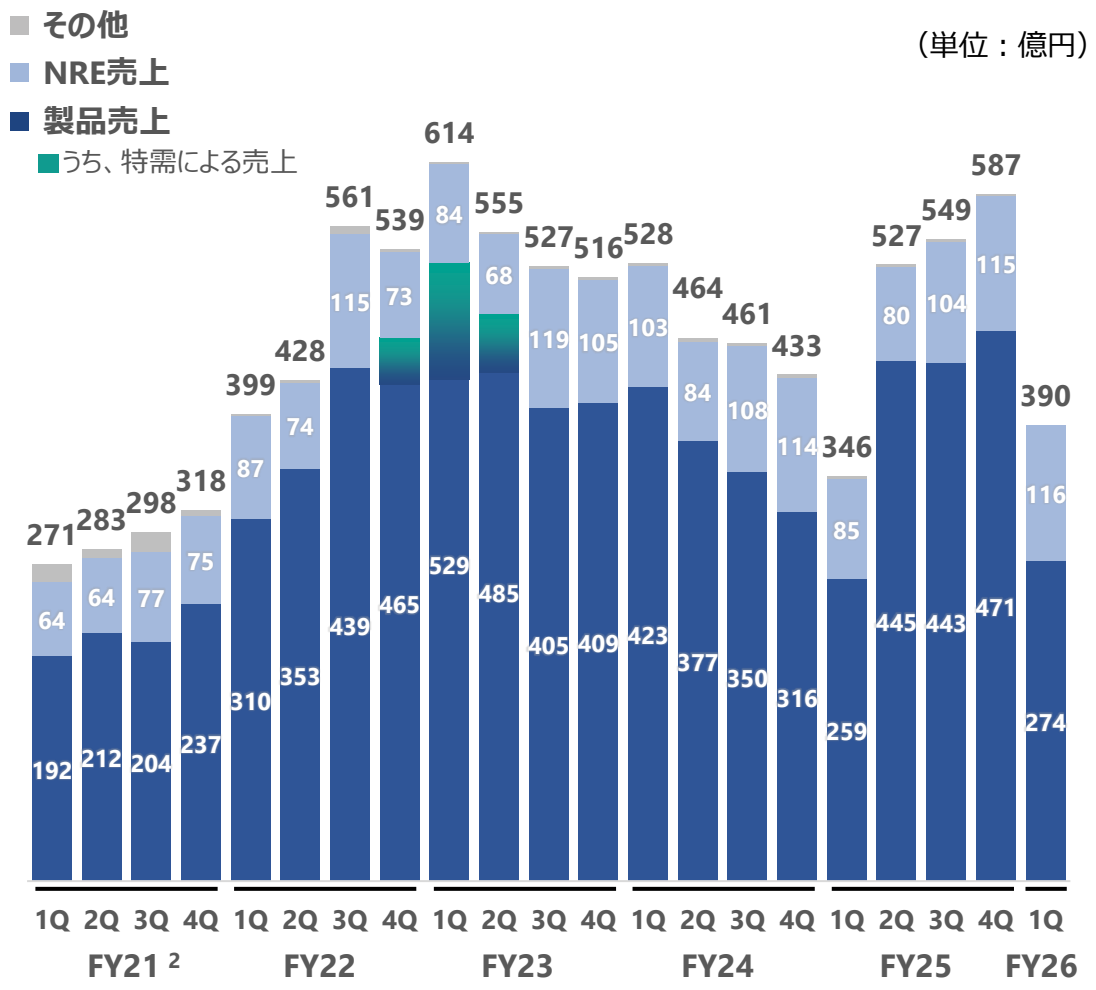
（単位：億円）

	2025年度 1Q	2025年度 2Q	2025年度 3Q	2025年度 4Q	2026年度 1Q	前年同期比	前年同期比 増減率	前四半期比	前四半期比 増減率
売上高	**346**	**527**	**549**	**587**	**390**	**+45**	**+13.0%**	**-197**	**-33.5%**
製品売上	259	445	443	471	274	+15	+5.9%	-197	-41.9%
NRE売上	85	80	104	115	116	+31	+37.1%	+1	+1.1%
その他	2	2	2	1	0	-2	-79.2%	-1	-57.9%
売上原価	**144**	**309**	**311**	**347**	**177**	**+33**	**+23.0%**	**-170**	**-48.9%**
製品売上原価率	55.6%	69.4%	70.2%	73.6%	64.7%	+9.0pt		-8.9pt	
販売費及び一般管理費	**187**	**195**	**204**	**189**	**220**	**+33**	**+17.5%**	**+31**	**+16.5%**
研究開発費	142	147	153	143	170	+27	+19.2%	+27	+18.7%
販売費・管理費	45	47	51	46	50	+5	+11.9%	+4	+9.6%
営業利益	**14**	**23**	**34**	**52**	**-7**	**-21**		**-58**	
営業利益率	4.2%	4.4%	6.3%	8.8%	-1.7%	-5.9pt		-10.5pt	
当期純利益	**5**	**16**	**27**	**40**	**-6**	**-10**		**-45**	
純利益率	1.3%	3.0%	5.0%	6.7%	-1.5%	-2.8pt		-8.2pt	
為替レート (USD/JPY)	**144.6**	**147.5**	**154.2**	**156.9**	**159.5**	**+14.9**		**+2.6**	

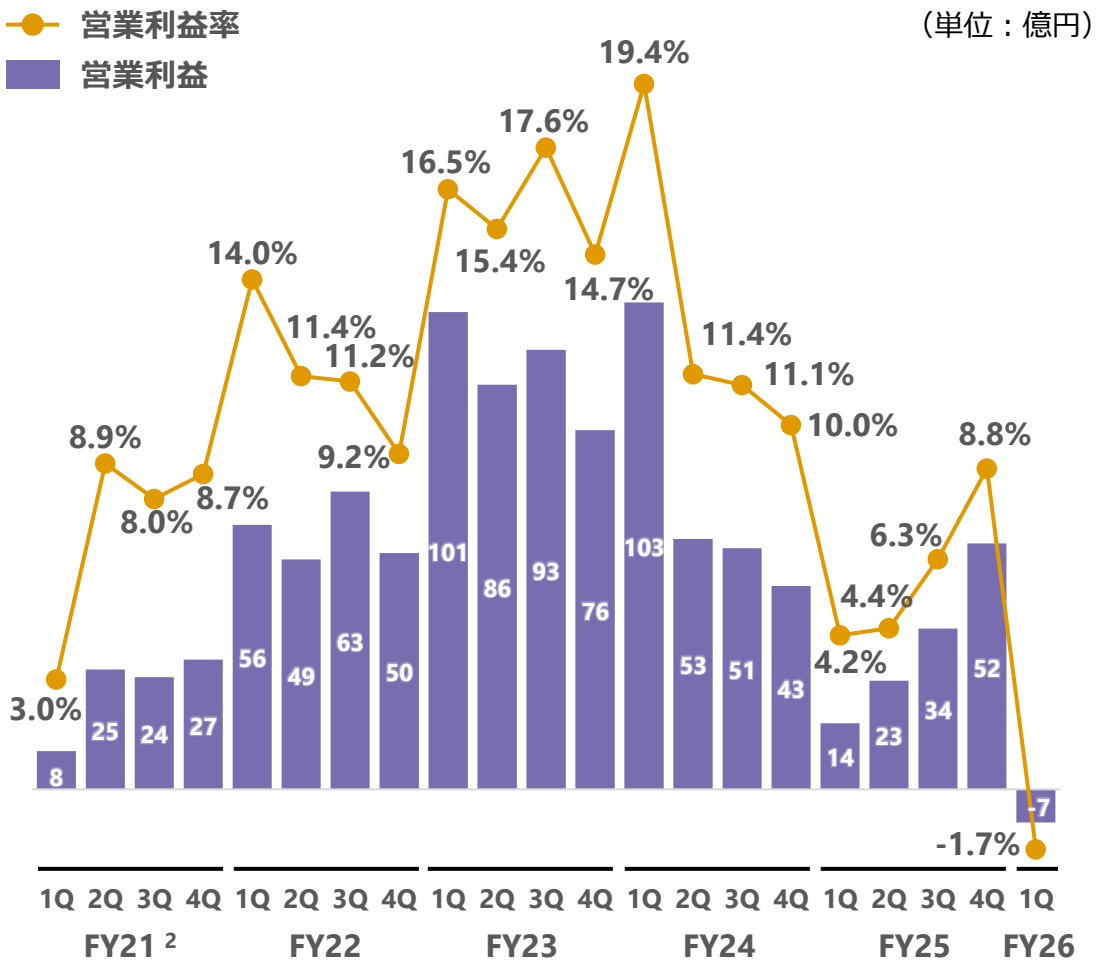
Copyright 2026 Socionext Inc.

四半期別の売上高及び営業利益の推移

売上高[1]



営業利益[1]

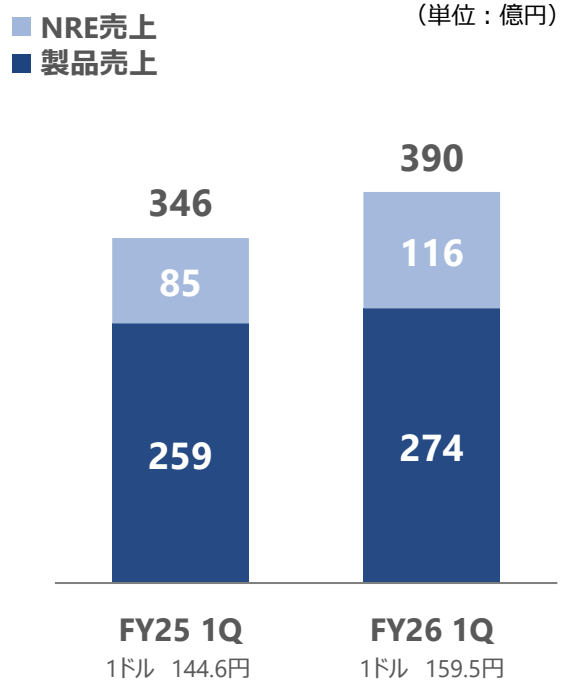


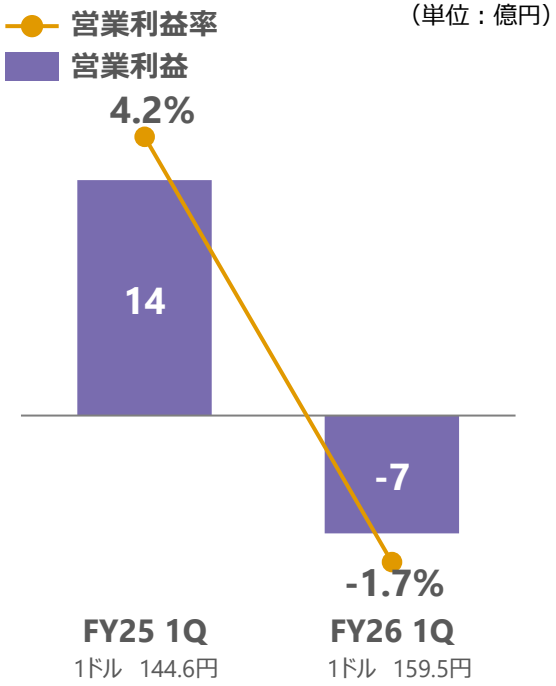
1. 四半期における数値は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。
2. 2021年度の四半期の数値については、監査法人による監査及びレビューを行っておりません。

Copyright 2026 Socionext Inc.

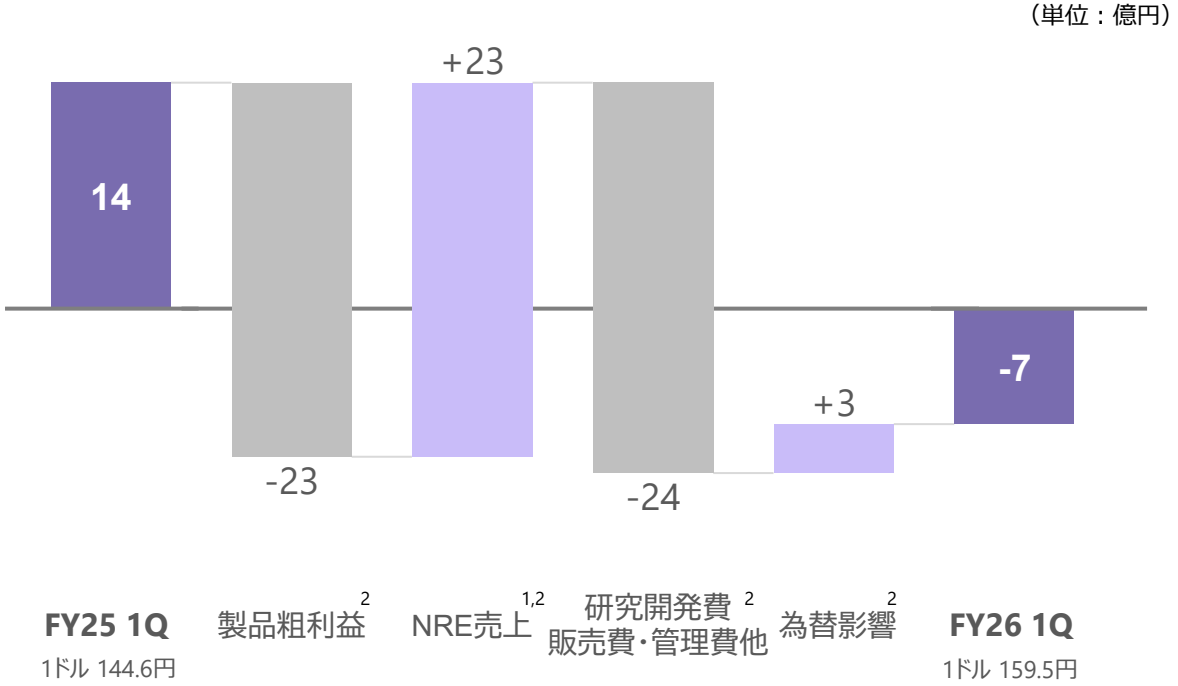
2026年度第1四半期 決算内容詳細（前年同期比）

売上高、営業利益　前年同期比





営業利益　前年同期比の変動内容



<売上高> 前年同期比 +45億円 （+13.0%）

- ➢ 製品売上　+15億円　（うち、為替影響 +22億円）
- ➢ NRE売上　+31億円　（うち、為替影響 +9億円）
  （1ドル144.6円→159.5円）

<営業利益> 前年同期比 -21億円

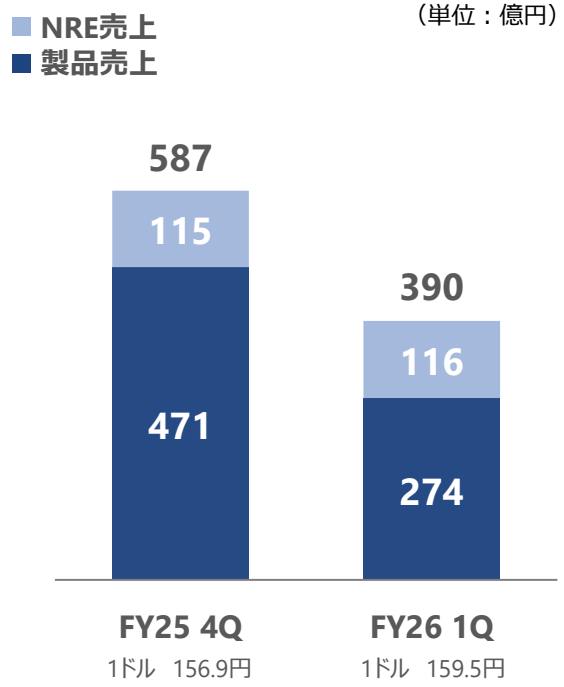
- ➢ 製品粗利益減　-23億円
- ➢ NRE売上増　+23億円
- ➢ 研究開発費・販管費増他　-24億円
- ➢ 為替影響　+3億円　（1ドル144.6円→159.5円）

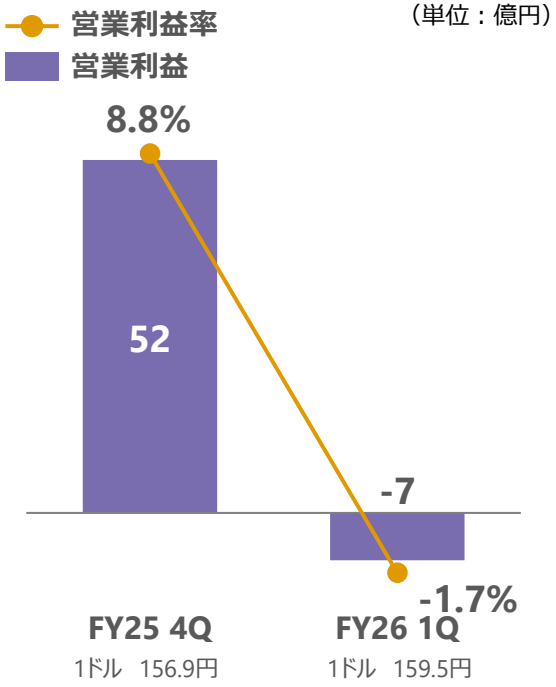
1. NRE売上に関連する研究開発費は費用として計上されます。したがって、NRE売上の全額が営業利益に寄与するわけではありません。
2. 為替影響は前年同期比又は前四半期比での為替レートの変動によるものです。営業利益の変動内訳に表記されている数値は為替影響を除いた数値となります。

Copyright 2026 Socionext Inc.

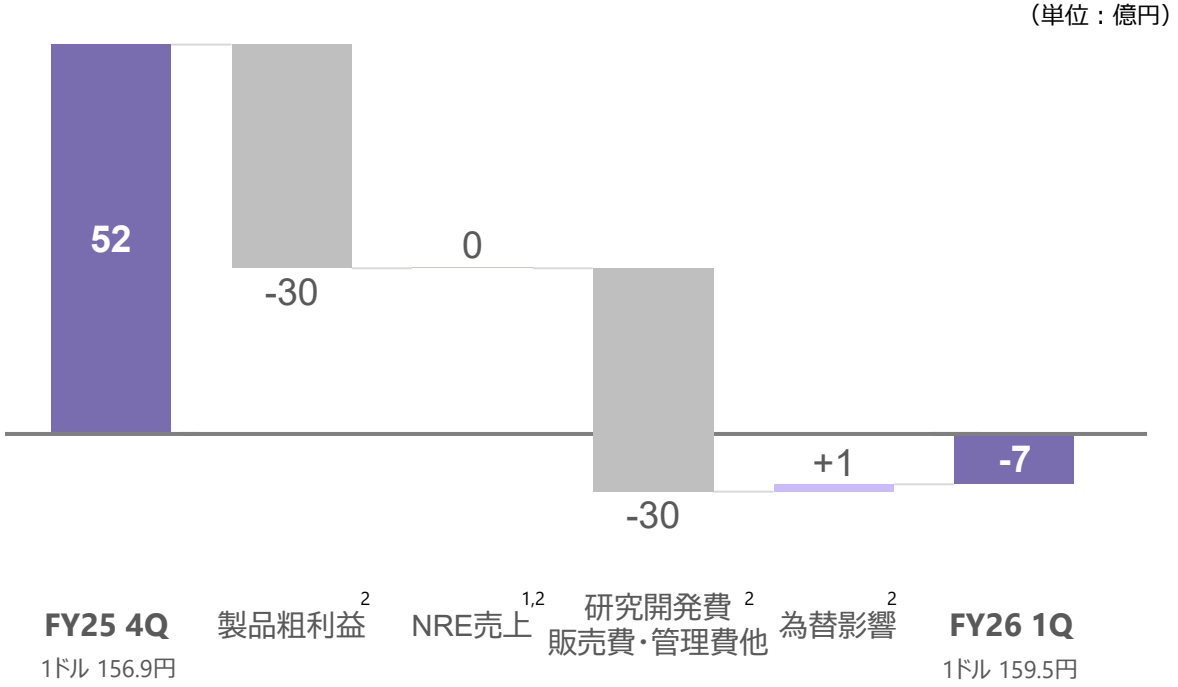
2026年度第1四半期 決算内容詳細（前四半期比）

売上高、営業利益　前四半期比





営業利益　前四半期比の変動内容



<売上高> 前四半期比 -197億円 （-33.5%）

- ➢ 製品売上　-197億円　（うち、為替影響　+4億円）
- ➢ NRE売上　+1億円　（うち、為替影響　+2億円）
  （1ドル156.9円→159.5円）

<営業利益> 前四半期比 -58億円

- ➢ 製品粗利益減　-30億円
- ➢ NRE売上　0億円
- ➢ 研究開発費・販管費増他　-30億円
- ➢ 為替影響　+1億円　（1ドル156.9円→159.5円）

1. NRE売上に関連する研究開発費は費用として計上されます。したがって、NRE売上の全額が営業利益に寄与するわけではありません。
2. 為替影響は前年同期比又は前四半期比での為替レートの変動によるものです。営業利益の変動内訳に表記されている数値は為替影響を除いた数値となります。

Copyright 2026 Socionext Inc.

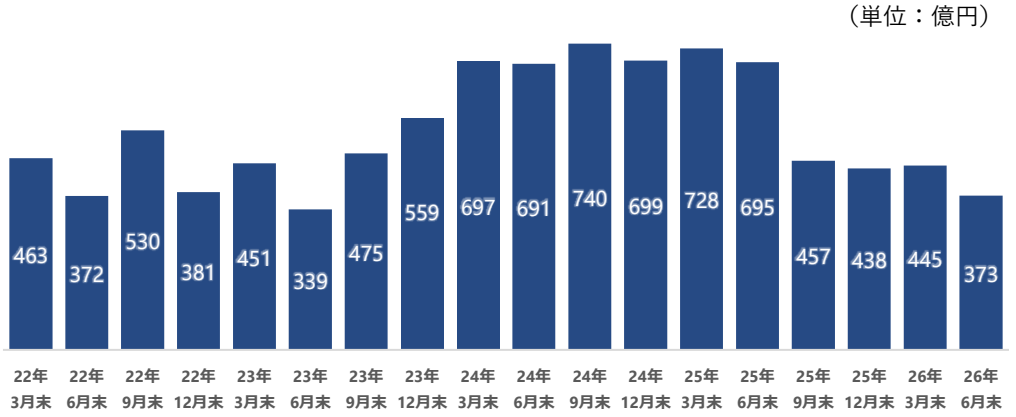
連結貸借対照表（2026年6月末時点）

（単位：億円）

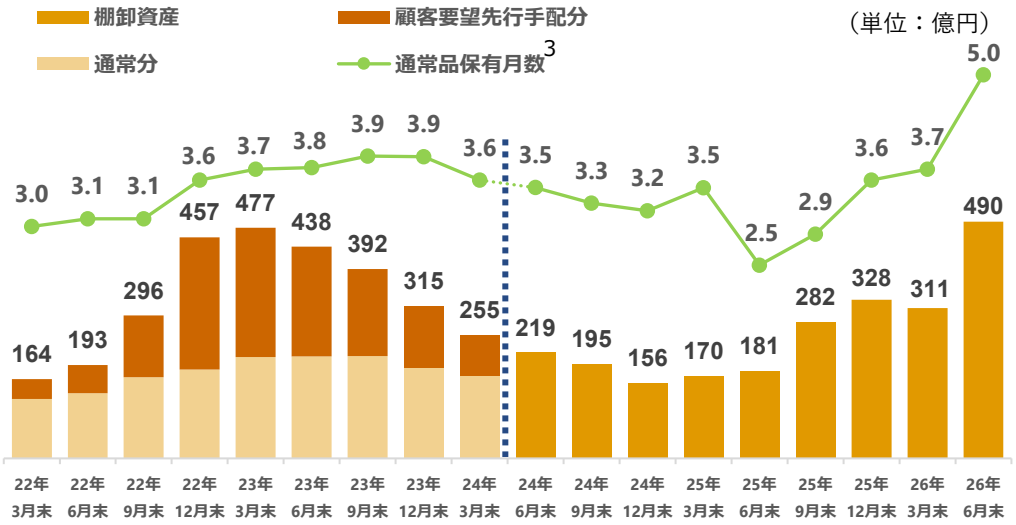
	2026年 3月末	2026年 6月末	前年度末比
総資産	1,676	**1,734**	+58
流動資産	1,228	**1,226**	-2
現預金[1]	445	**373**	-72
売掛金	369	**238**	-131
棚卸資産[2]	311	**490**	+179
未収入金	44	**46**	+2
固定資産	448	**508**	+60
負債	346	**449**	+103
流動負債	325	**427**	+102
買掛金	158	**201**	+43
未払金	40	**74**	+35
純資産	1,331	**1,285**	-45
自己資本比率	79.4%	**74.1%**	

1. 現預金には短期保有有価証券を含みます。
2. 棚卸資産は製品と仕掛品の合計です。
3. 通常品保有月数＝ 通常品棚卸資産金額÷次期3カ月平均の製品原価金額見通し

現預金残高[1]



棚卸資産残高[2]

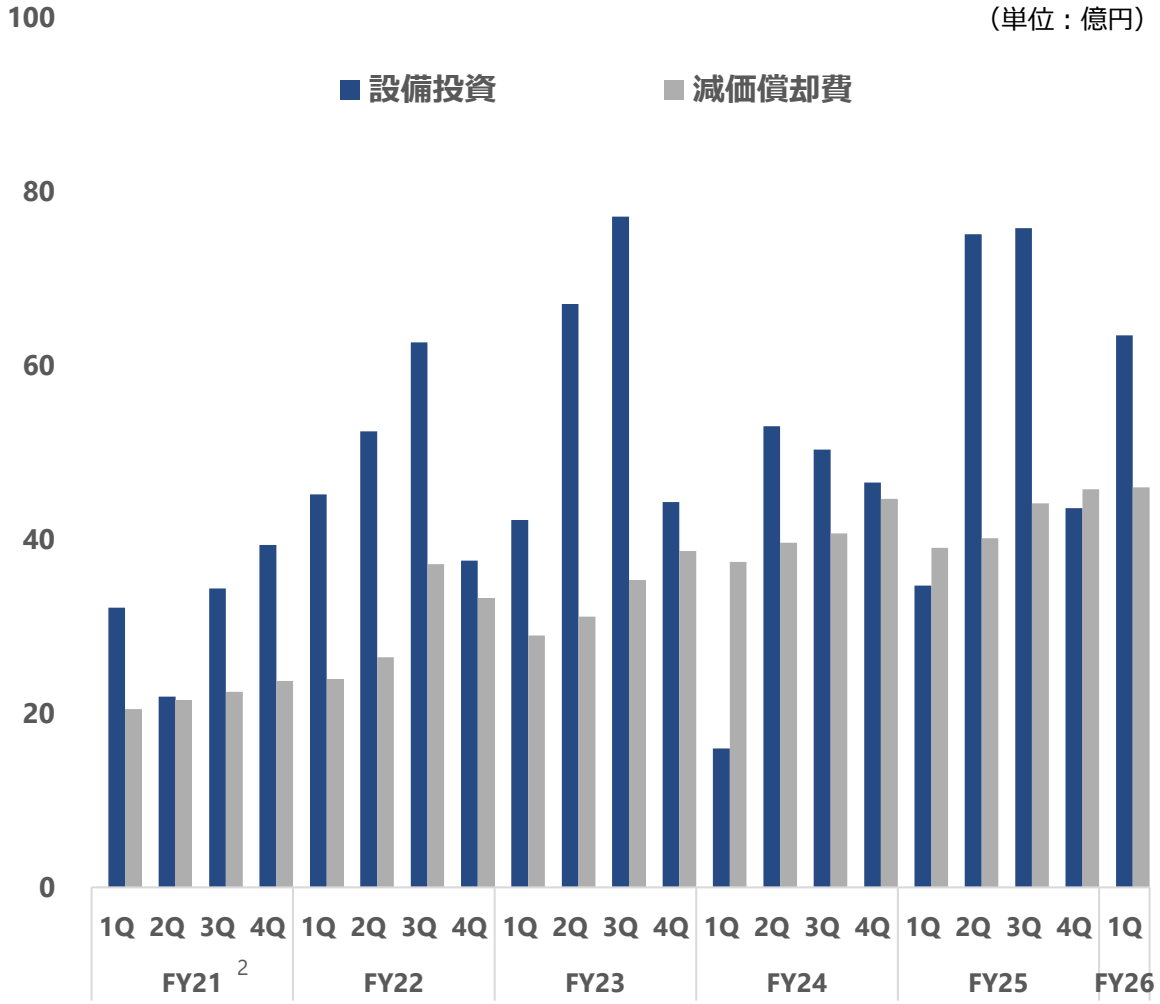


＊2024年度より顧客要望先行手配分と通常分を合計し、棚卸資産として開示しています。

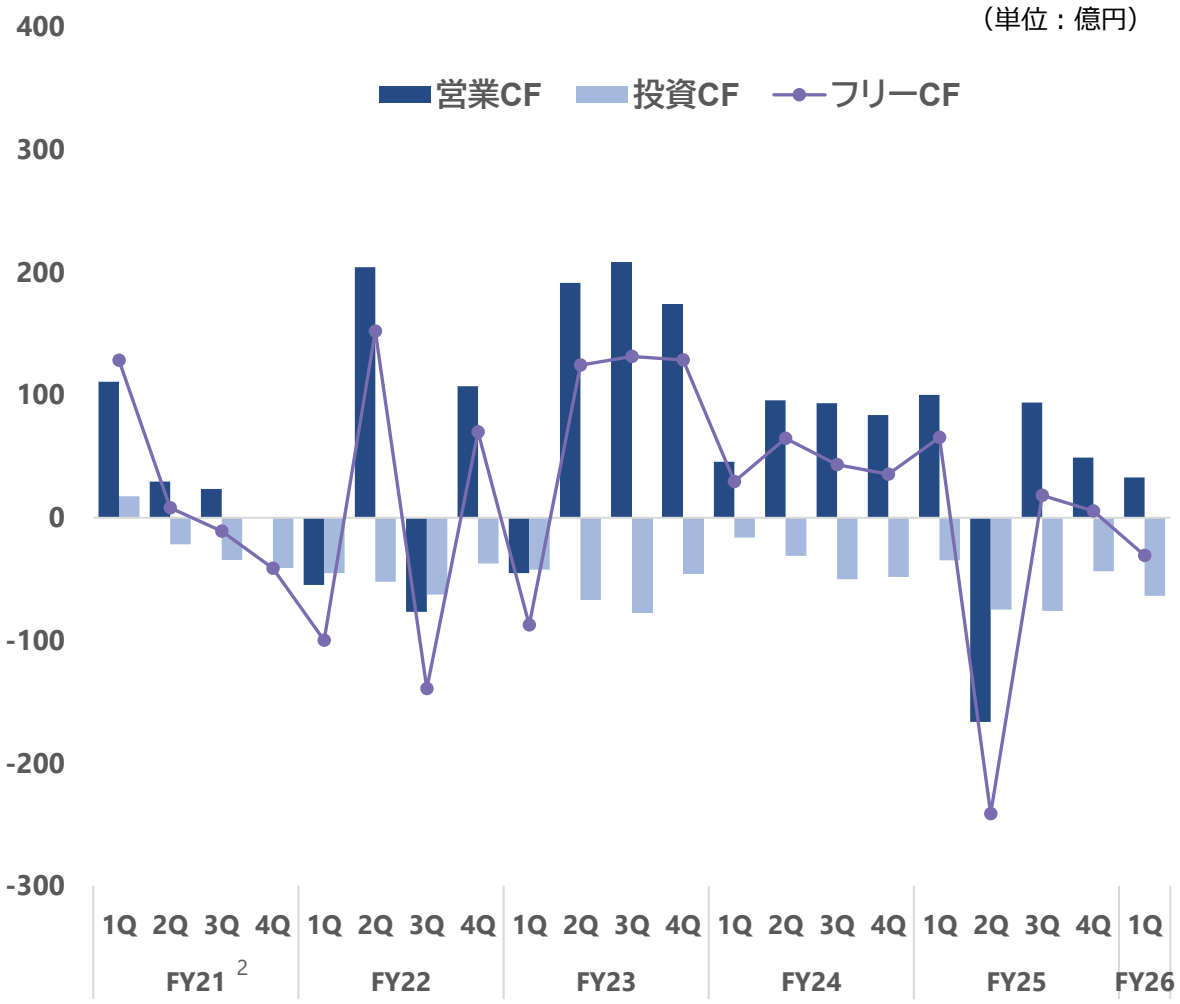
Copyright 2026 Socionext Inc.

設備投資　減価償却費 / キャッシュフロー

設備投資[1]-減価償却費



キャッシュフロー

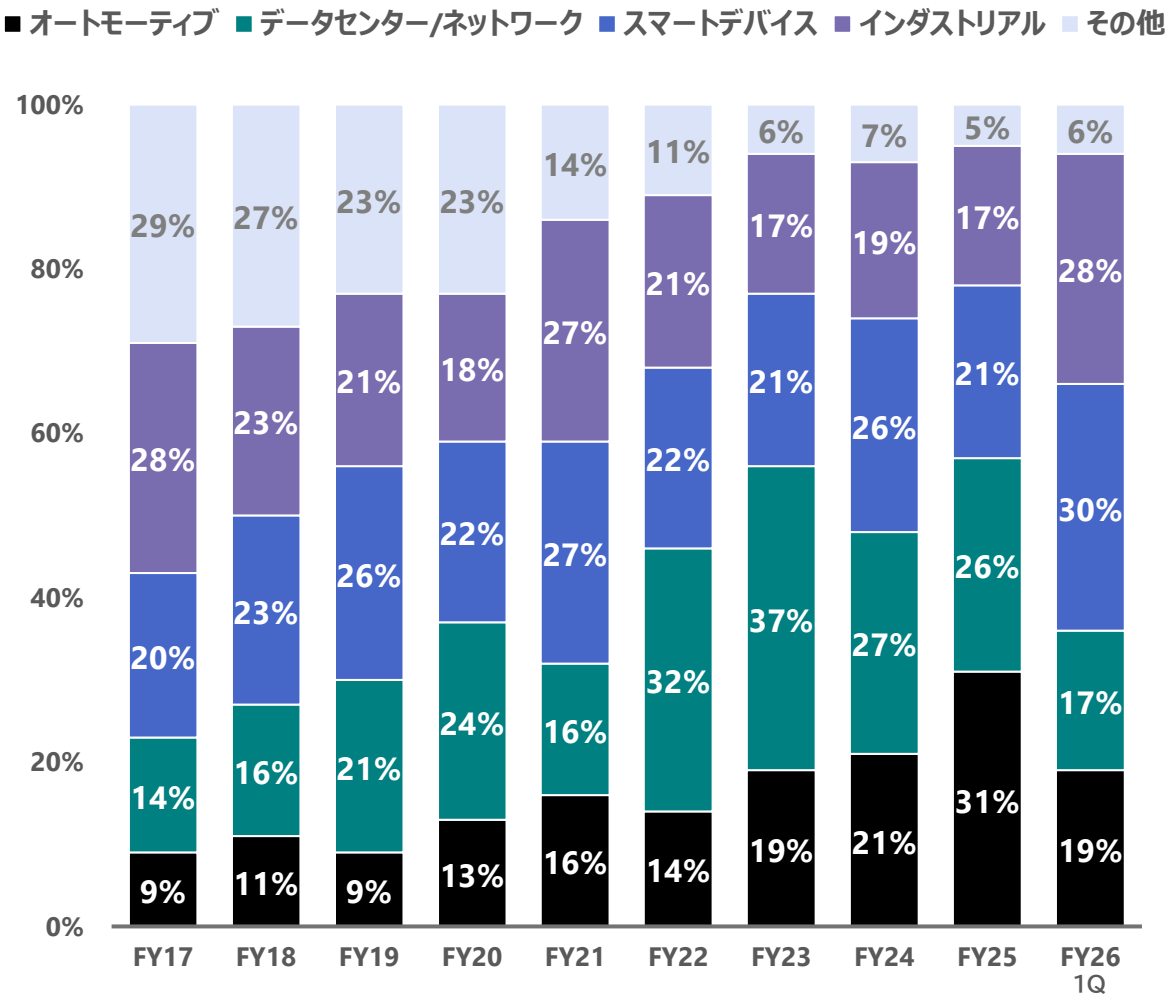


1. 設備投資=有形固定資産の取得による支出+無形固定資産の取得による支出
2. 2021年度の四半期の数値については、監査法人による監査及びレビューを行っていません。

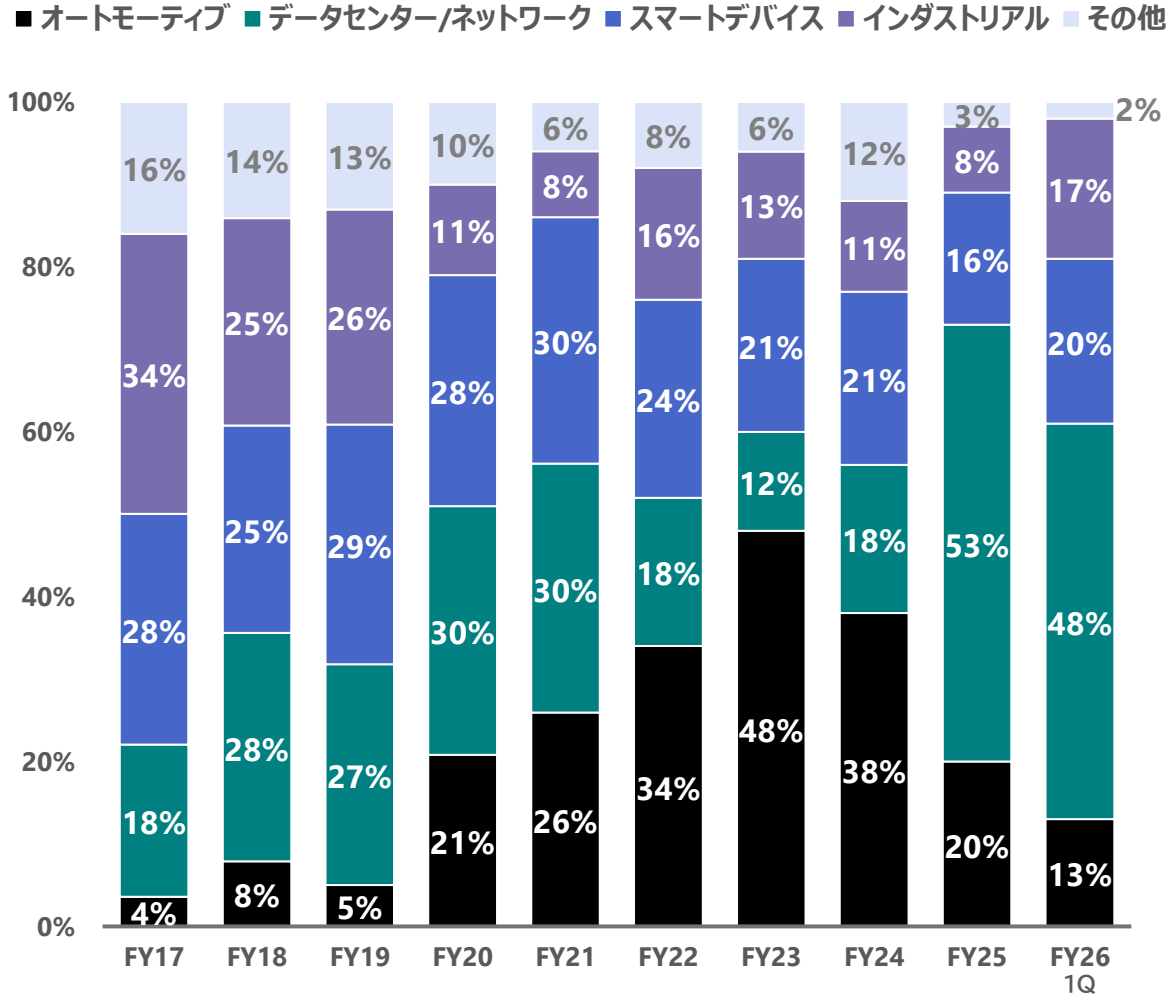
Copyright 2026 Socionext Inc.

売上の内訳（アプリケーション別）

売上高



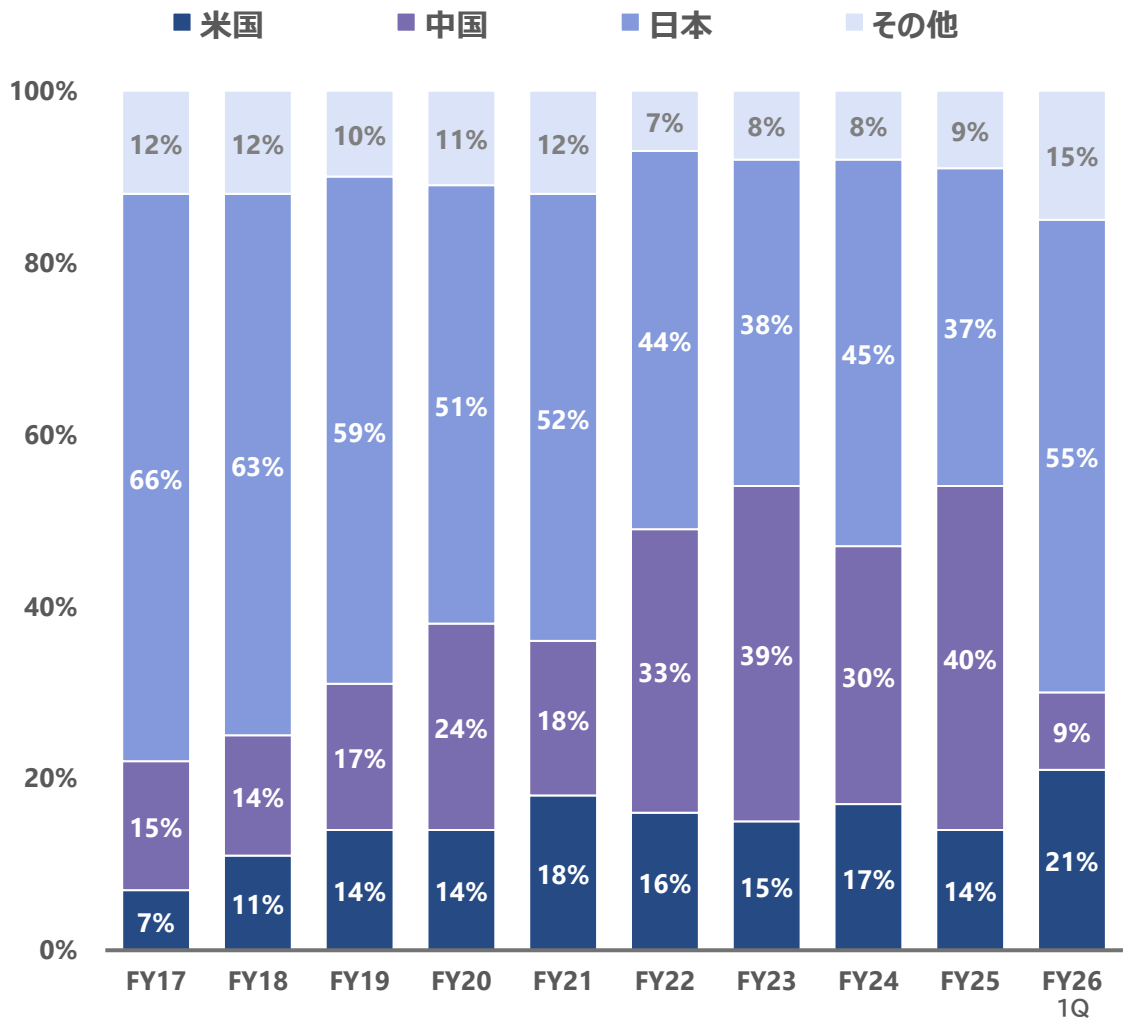
NRE売上



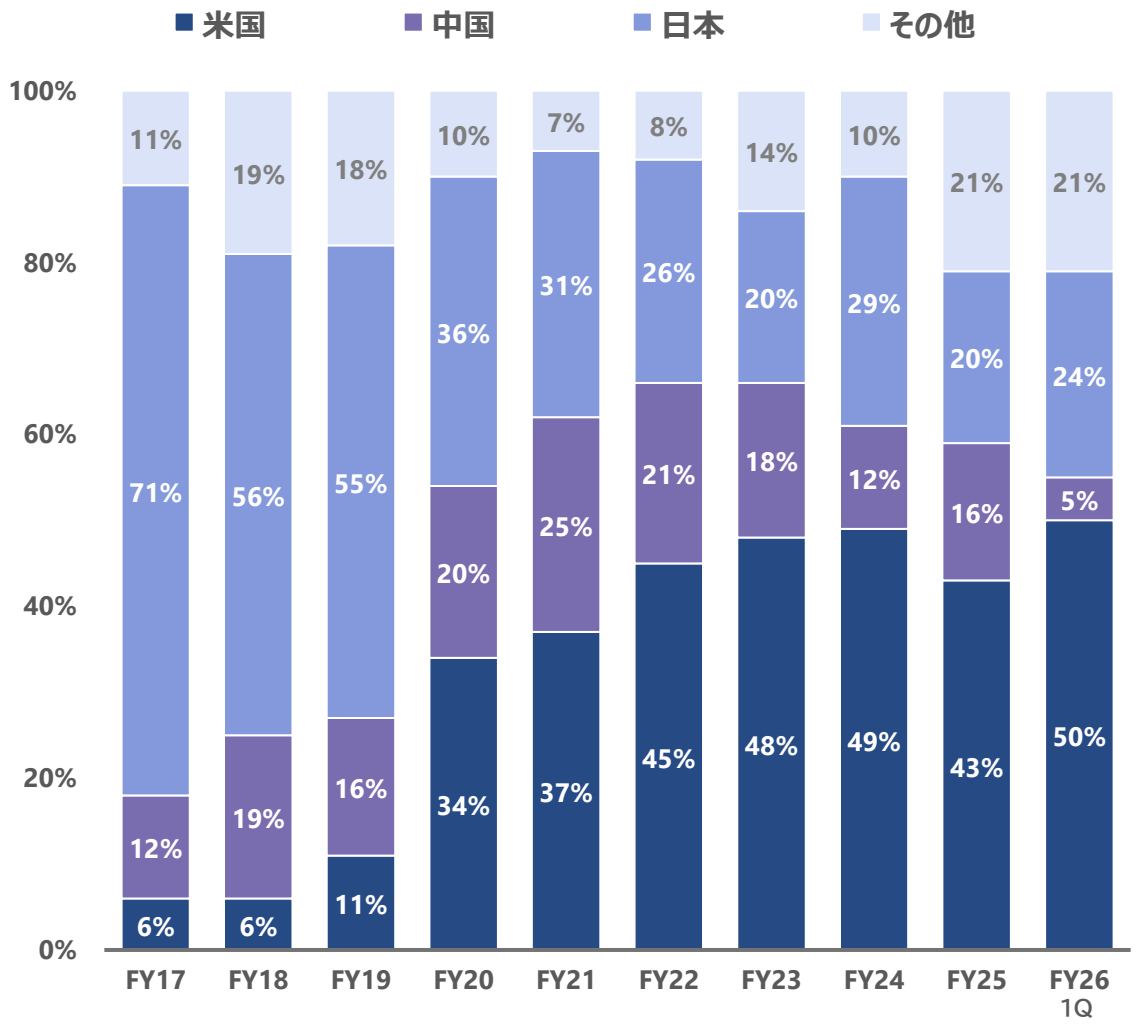
Copyright 2026 Socionext Inc.

売上の内訳（地域別）

売上高



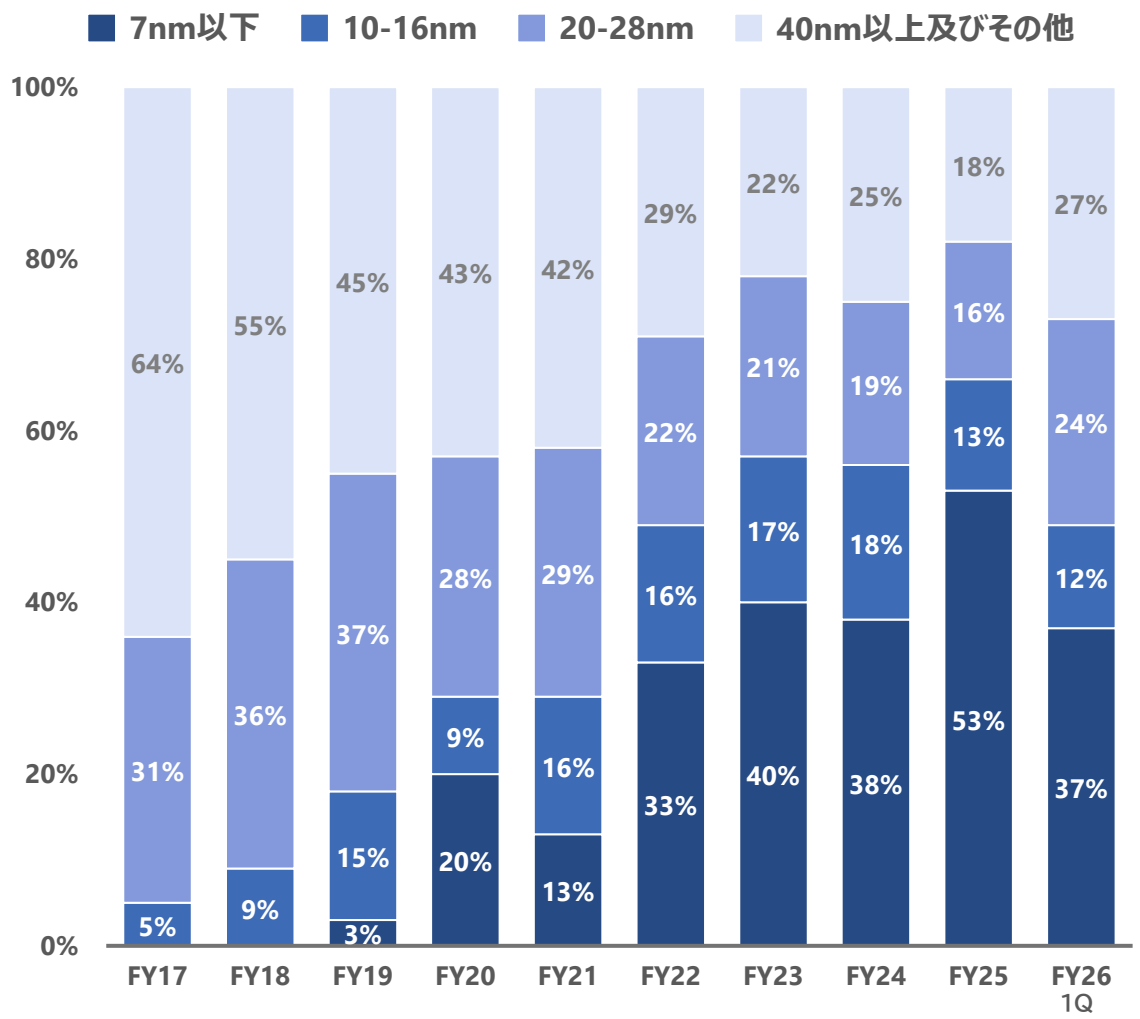
NRE売上



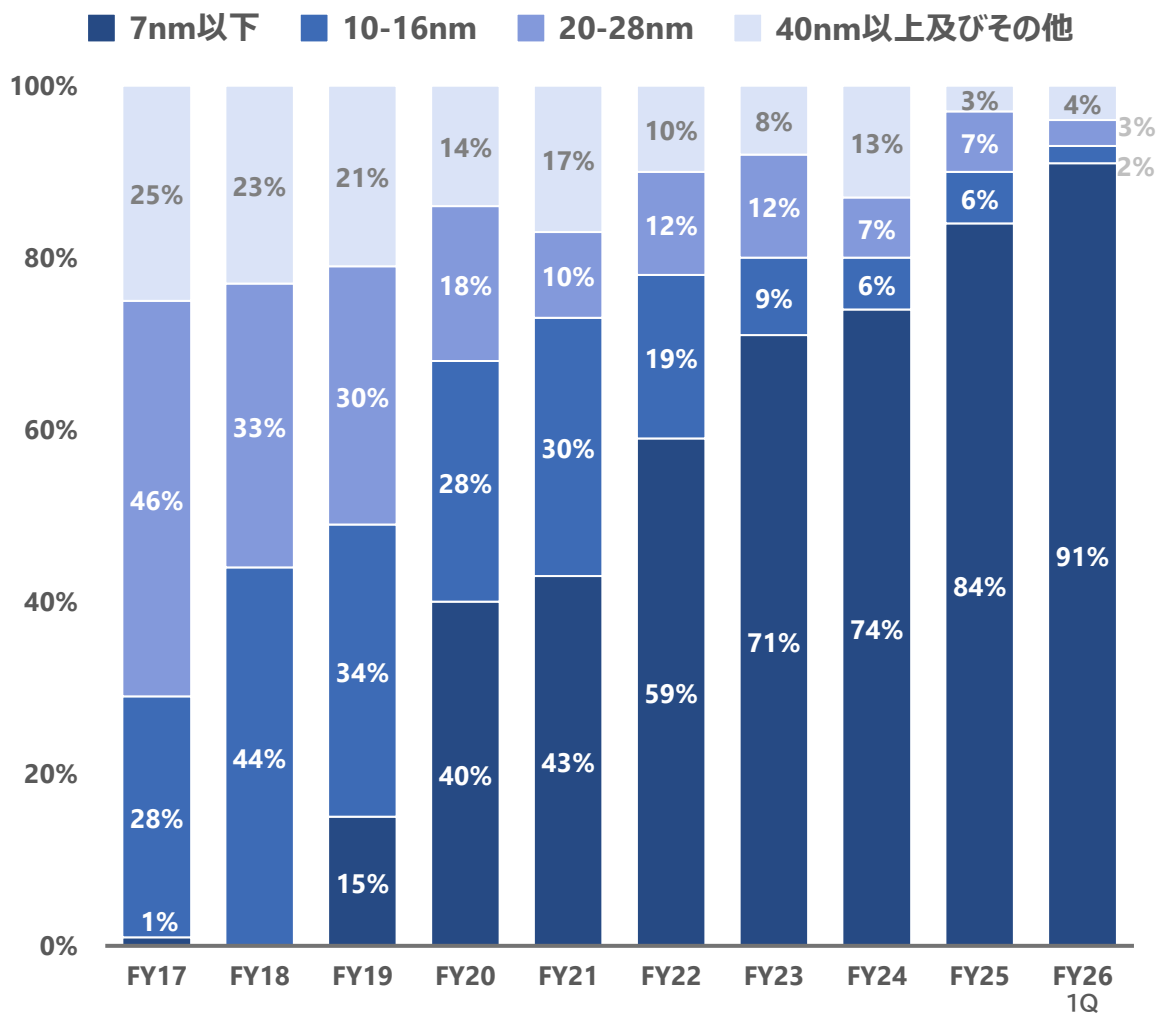
Copyright 2026 Socionext Inc.

売上の内訳（プロセスノード別）

売上高



NRE売上



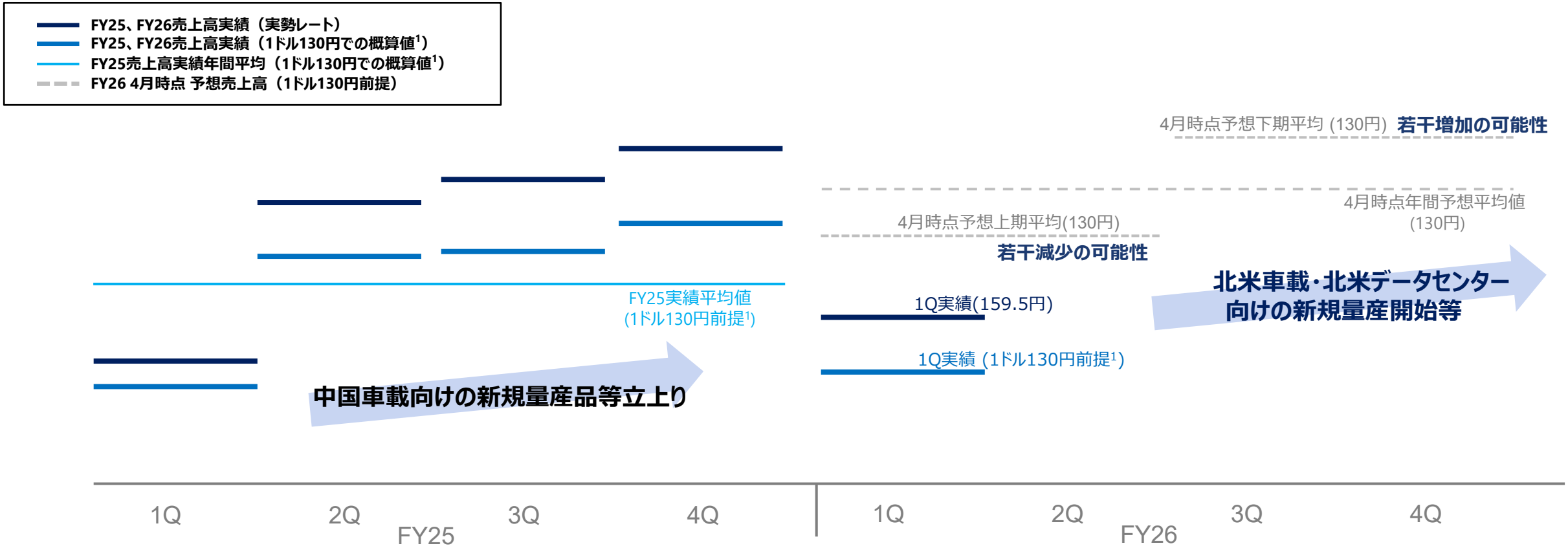
Copyright 2026 Socionext Inc.

2026年度第1四半期 連結決算

- 2026年度第1四半期 連結決算概要
- 2026年度通期 予想

売上高トレンド

2026年4月決算説明会
掲載資料に加筆



- ◆ FY26上期　・FY25新規量産開始の中国車載向け製品が引き続き好調（1Qから2Qに売上がシフト）
- ◆ FY26下期　・北米車載・北米データセンター向け製品の新規量産開始により売上増
- ◆ 営業利益率　・上期が低く、下期に向かって改善していく見通し
  （年間では変わらないものの、開発費の増加、NRE売上のタイミングにより、上期は当初想定よりも若干減少する可能性がある）

1.年度を超えて変動を示すため、売上実績を1ドル130円で計算した概算値です。

Copyright 2026 Socionext Inc.

2026年度 通期予想

2026年4月決算説明会
掲載資料

（単位：億円）

	2025年度 実績	2026年度予想 4月時点	前年比	増減率	（ご参考）※前年度の為替レートを用いて注記の為替感応度に沿って2026年度予想を計算した数値
売上高	**2,008**	**2,150**	+142	7.1%	2,358
営業利益	**124**	**140**	+16	13.3%	192
営業利益率	**6.2%**	**6.5%**	+0.4pt		8.1%
当期純利益	**87**	**100**	+13	14.5%	–
当期純利益率	**4.3%**	**4.7%**	+0.3pt		–
1株当たり当期純利益[1]	**49円74銭**	**57円02銭[2]**			–
1株当たり配当金	**50円00銭**	**50円00銭**			–
為替レート（USD/JPY）	**150.8円**	**130.0円**			150.8円 ※前年度の為替レート

- 2026年度４月時点予想における為替感応度は、ドルに対して1円の変動で、売上高約10億円、営業利益約2.5億円、他の通貨についての影響は軽微と想定しています。ただし、外貨建てによる売上高・仕入高・棚卸資産金額と、研究開発費の発生時期により、四半期毎にその影響は異なります。

1. 2025年４月決算発表における2025年度実績の1株当たり当期純利益は175,560,577株、4月時点の2026年度予想は175,279,761株を前提に算出しました。
2. 今回、4月時点の2026年度予想を、発行済株式総数175,376,573株を前提に算出し、更新しました。

Copyright 2026 Socionext Inc.

socionext™
The Solution SoC Company

Appendix:

Overview

- 連結損益計算書・連結貸借対照表
- 売上高の内訳 四半期別

連結損益計算書

（単位：億円）	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度 1Q
売上高	997	1,170	1,928	2,212	1,885	2,008	390
前年同期比増減率	-3.7%	+17.3%	+64.7%	+14.8%	-14.8%	+6.5%	+13.0%
製品売上	731	846	1,568	1,829	1,466	1,618	274
NRE 売上	230	281	349	376	410	383	116
その他売上	36	43	11	8	9	7	0
売上原価	432	498	1,039	1,112	846	1,111	177
売上総利益	565	673	888	1,100	1,039	898	213
売上総利益率	56.7%	57.5%	46.1%	49.7%	55.1%	44.7%	54.6%
製品粗利益率	40.9%	41.2%	33.7%	39.2%	42.3%	31.4%	35.3%
研究開発費	392	432	493	533	598	585	170
販売費及び一般管理費 (研究開発費除く)	158	156	178	212	191	189	50
営業利益	16	85	217	355	250	124	-7
営業利益率	1.6%	7.2%	11.3%	16.1%	13.3%	6.2%	-1.7%
営業外損益	4	6	17	16	1	-6	-1
経常利益	20	91	234	371	251	118	-8
特別利益	0	0	0	0	18	0	0
特別損失	0	0	0	0	15	0	0
税金等調整前純利益	20	91	234	371	254	118	-8
法人税等合計	5	16	37	110	58	30	-2
当期純利益	15	75	198	261	196	87	-6
純利益率	1.5%	6.4%	10.3%	11.8%	10.4%	4.3%	-1.5%
為替レート(USD/JPY)	106.1	112.4	135.5	144.6	152.6	150.8	159.5

Copyright 2026 Socionext Inc.

連結貸借対照表

(単位：億円)	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度 1Q
資産							
現金及び預金[1]	427	463	451	697	728	445	373
売掛金	286	251	408	353	316	369	238
棚卸資産[2]	67	164	477	255	170	311	490
その他	26	29	224	84	48	103	125
流動資産合計	806	906	1,561	1,389	1,263	1,228	1,226
有形固定資産	89	116	172	218	223	239	271
Reticle	37	47	56	81	97	109	112
その他有形固定資産	52	69	116	137	126	130	159
無形固定資産	116	122	130	185	144	151	177
繰延税金資産	23	31	69	67	61	46	49
その他	9	8	8	9	12	12	12
固定資産合計	237	278	379	479	440	448	508
資産合計	1,042	1,184	1,939	1,868	1,703	1,676	1,734

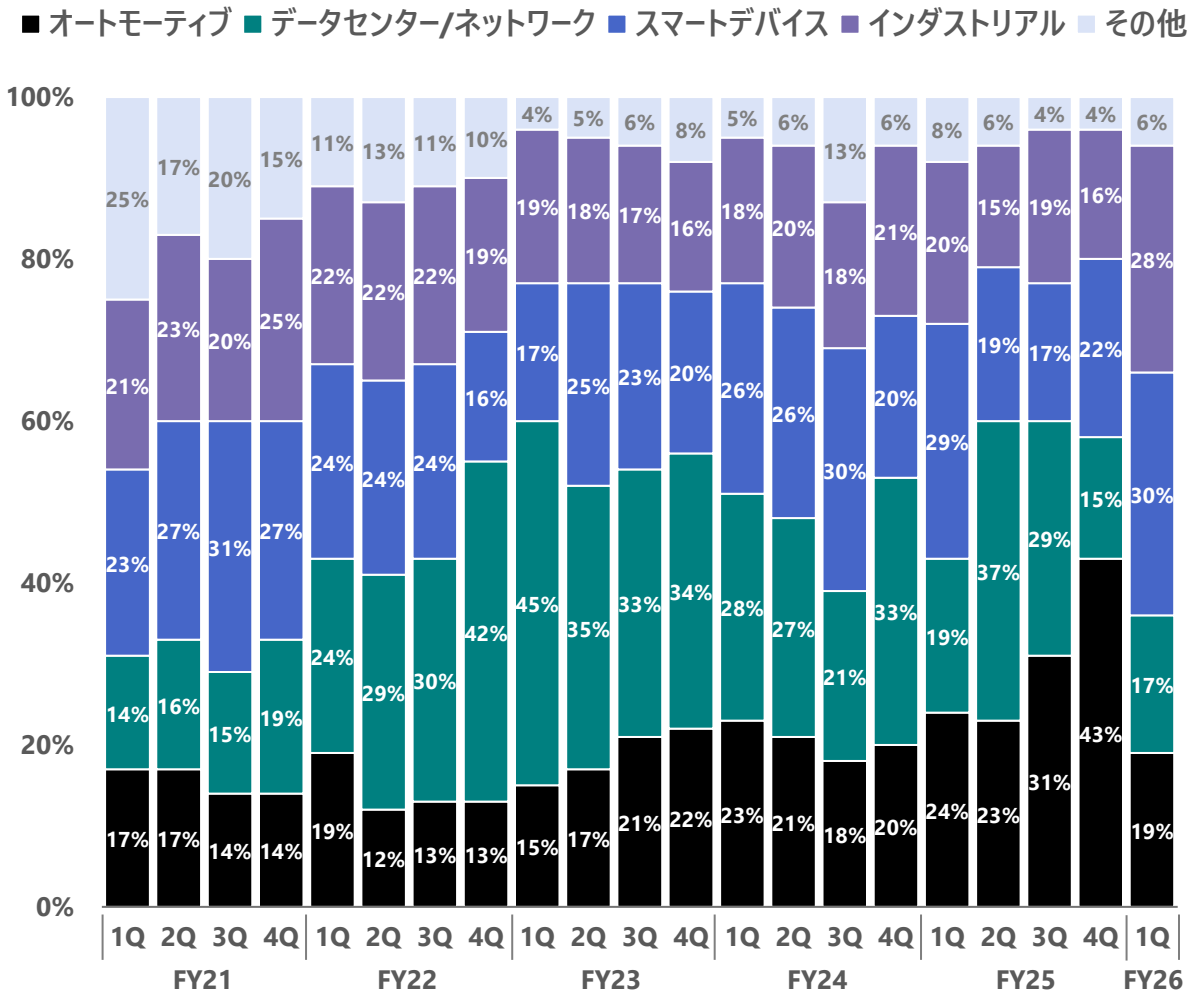
	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度 1Q
負債及び純資産							
買掛金	120	166	234	158	119	158	201
未払金･未払費用	74	69	303	182	120	96	113
その他	19	39	286	191	73	71	113
流動負債合計	213	274	823	531	313	325	427
固定負債合計	13	14	17	27	20	20	22
負債合計	226	288	841	558	333	346	449
資本金	302	302	302	327	330	330	330
資本剰余金	302	302	302	327	330	339	339
利益剰余金	214	289	486	636	743	741	691
自己株式	0	0	0	0	-50	-108	-105
その他	-1	3	8	20	18	27	29
純資産合計	817	896	1,099	1,310	1,370	1,331	1,285
負債純資産合計	1,042	1,184	1,939	1,868	1,703	1,676	1,734

1. 現金及び預金には短期保有有価証券を含みます。
2. 棚卸資産は製品と仕掛品の合計です。

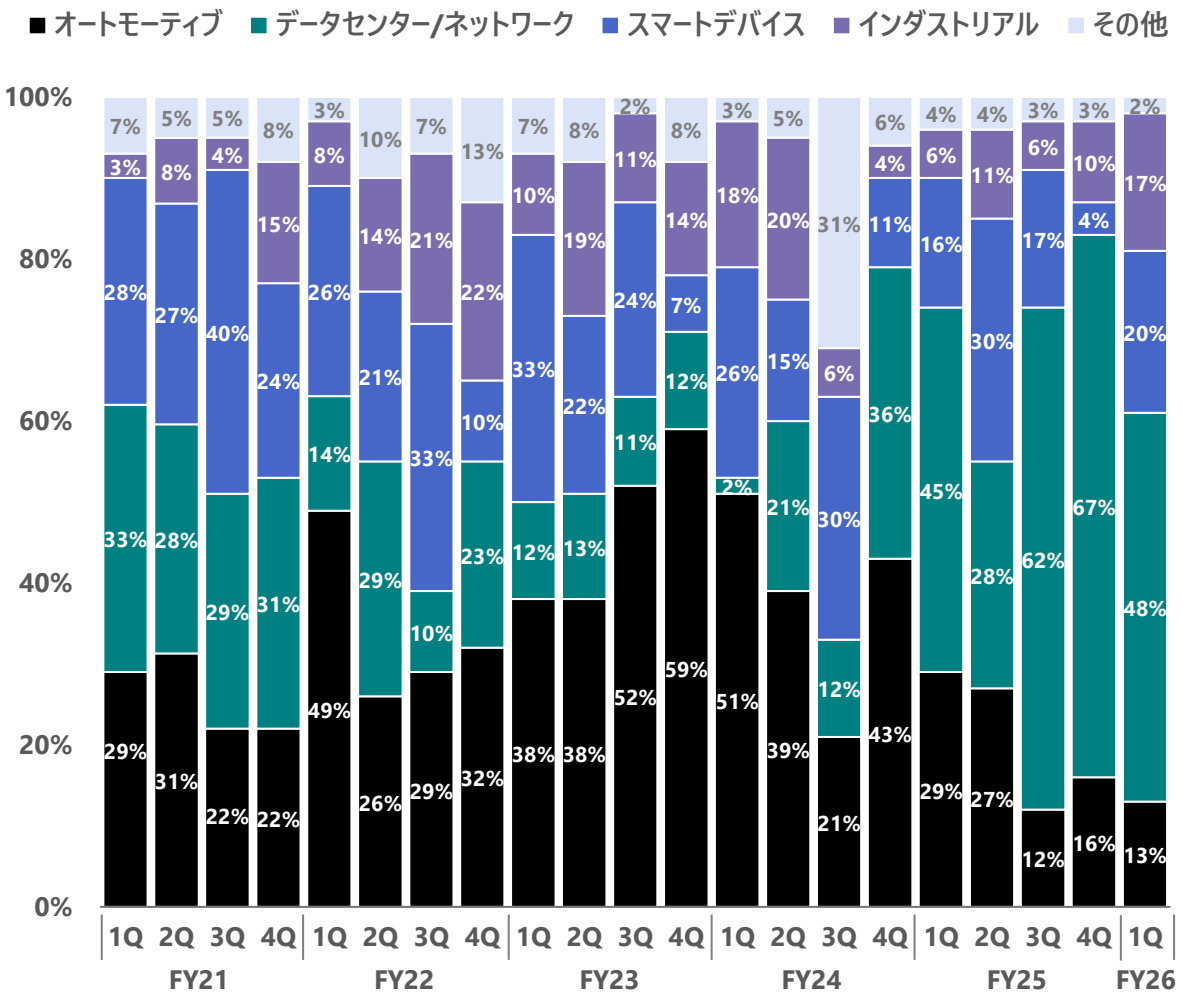
Copyright 2026 Socionext Inc.

売上の内訳（アプリケーション別）四半期別

売上高[1]



NRE売上[1]

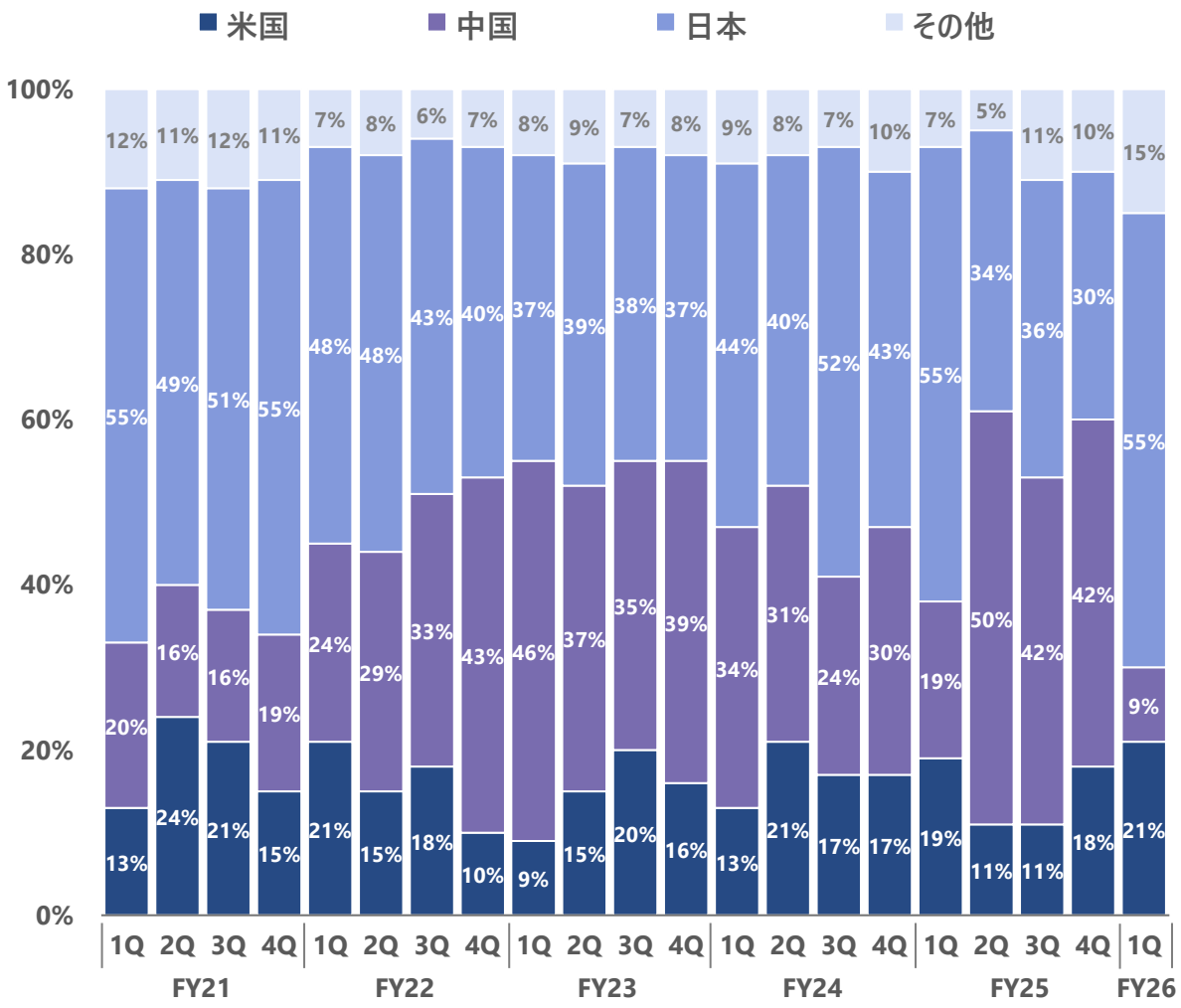


1. 四半期における比率は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。

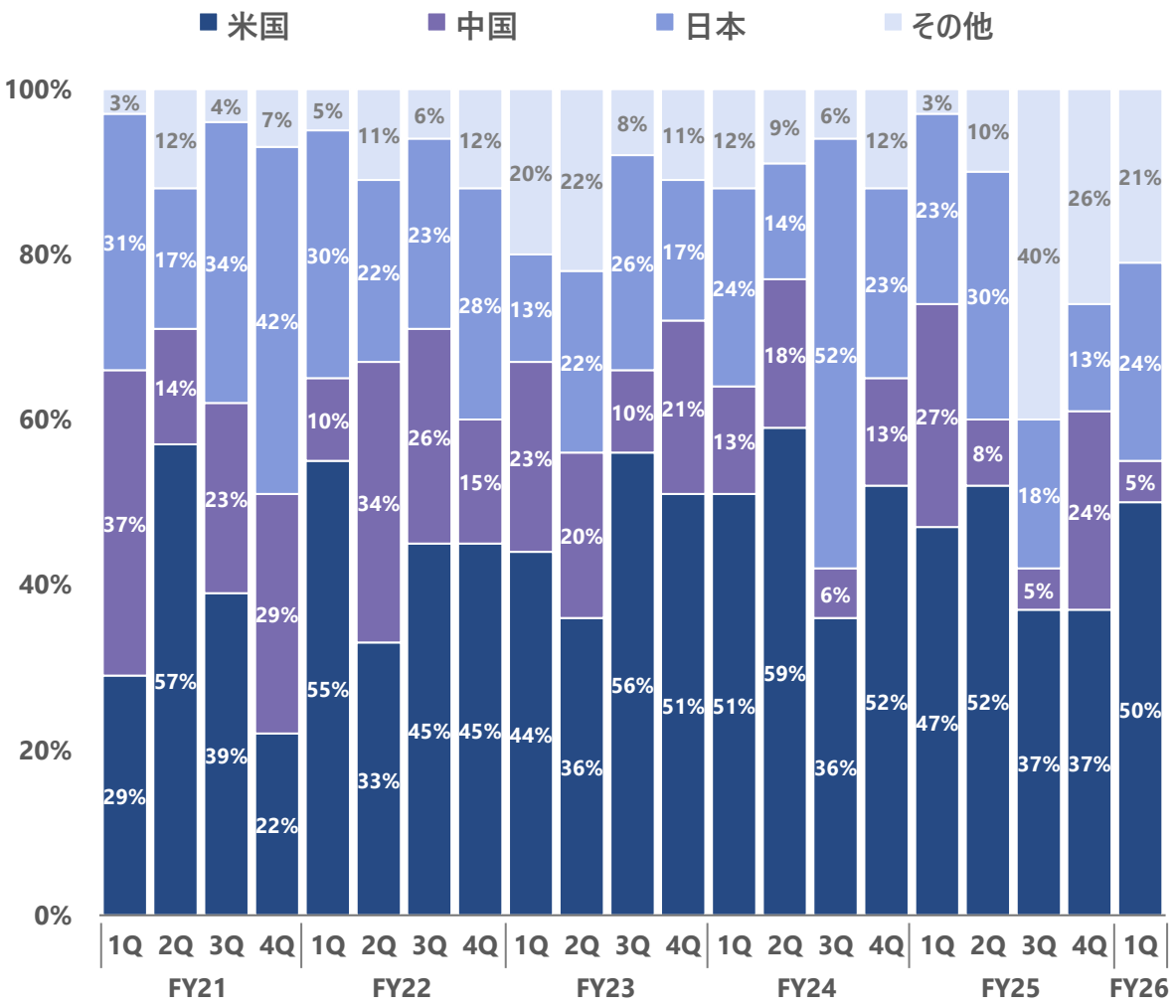
Copyright 2026 Socionext Inc.

売上の内訳（地域別）四半期別

売上高[1]



NRE売上[1]

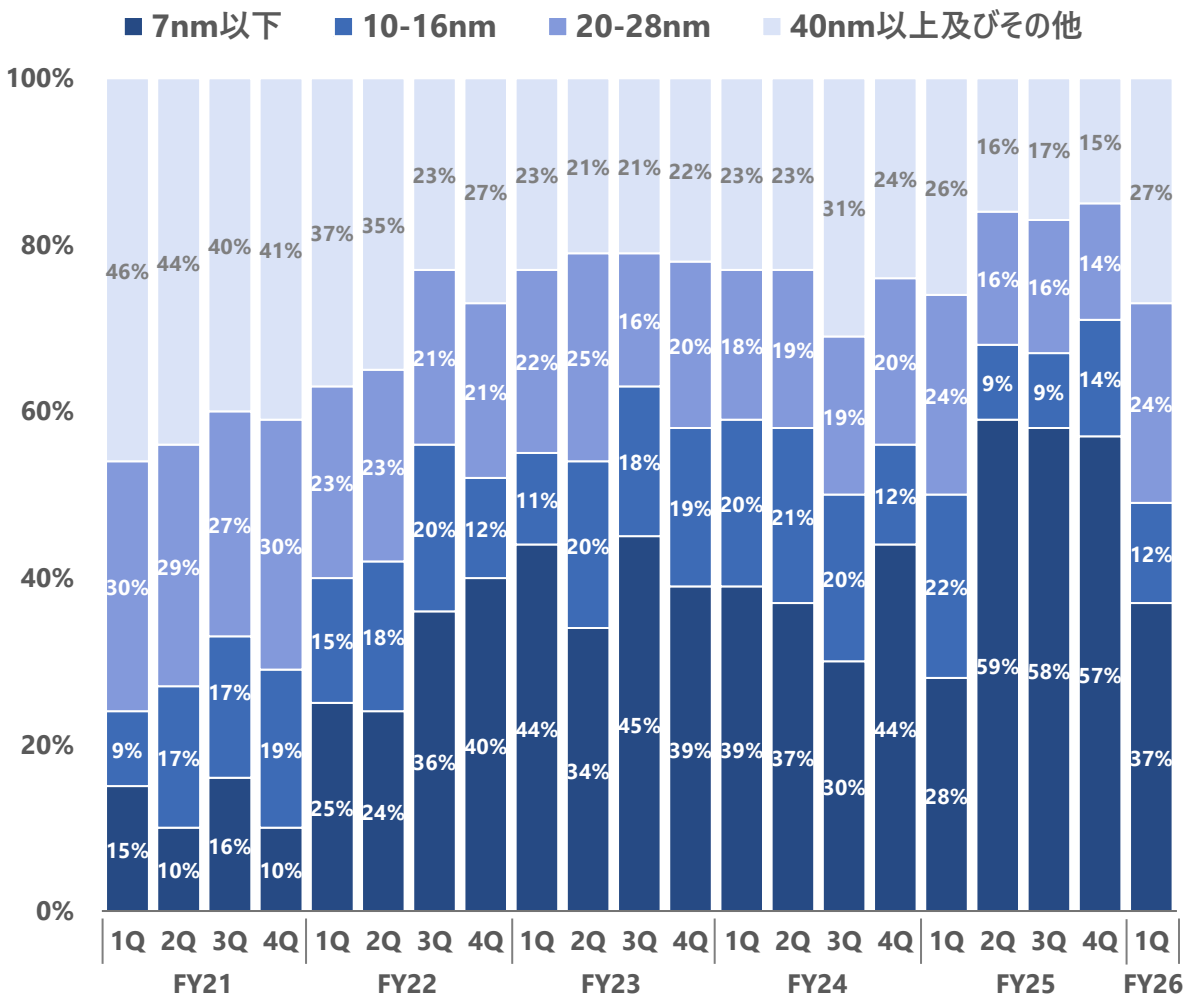


1. 四半期における比率は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。

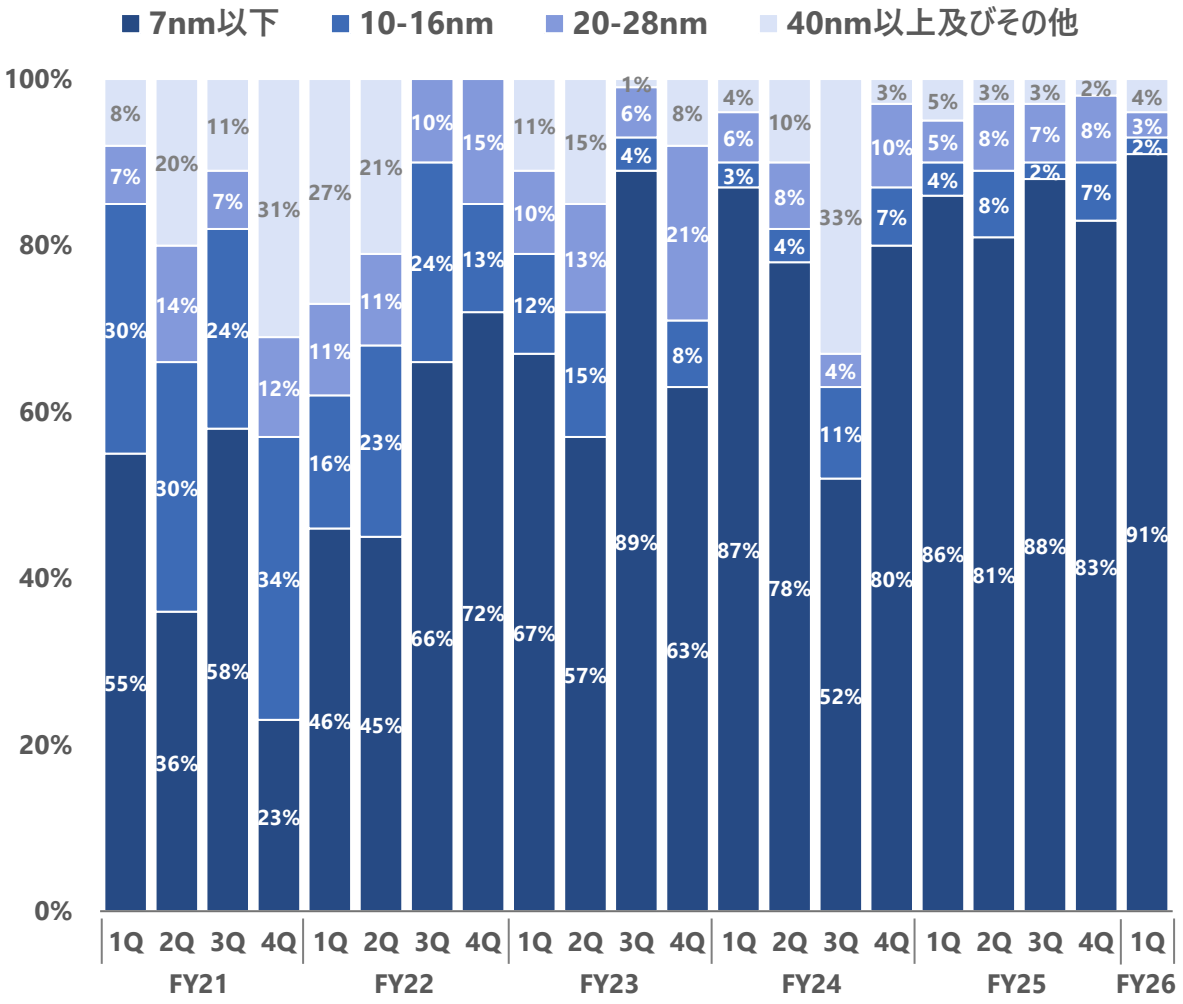
Copyright 2026 Socionext Inc.

売上の内訳（プロセスノード別）四半期別

売上高[1]



NRE売上[1]



1. 四半期における比率は、個別案件の開発状況の影響を大きく受けるため、ボラティリティが高く四半期毎に大きく変動する可能性があります。

Copyright 2026 Socionext Inc.

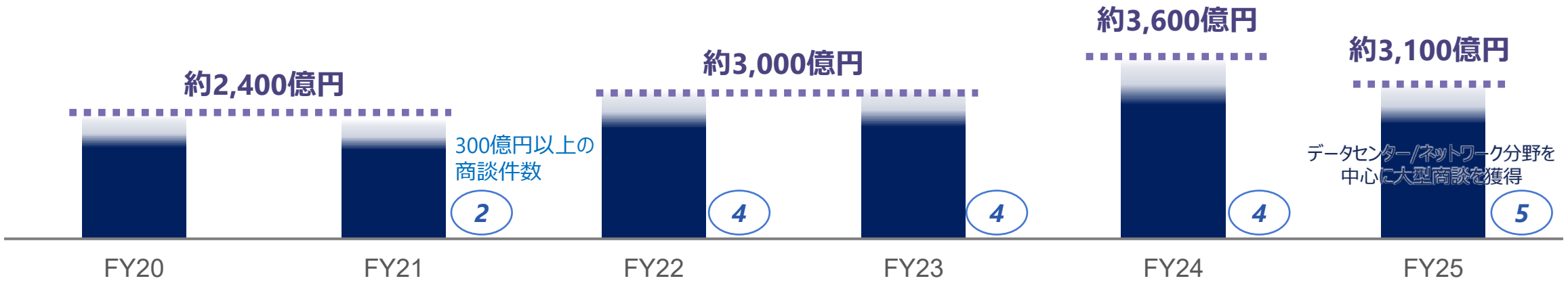
socionext™
The Solution SoC Company

以降、2026年4月決算説明会資料より再掲

商談獲得金額の推移

- 2025年度の商談獲得金額は、データセンター/ネットワーク分野などで大型商談を獲得し、前年度を下回ったものの3,100億円に（商談獲得が前年度の第4四半期に集中したこと、また、2025年度は獲得済商談の端境期であったこと、商談獲得時期が来年度前半にずれ込んだことなども影響）

各年度に獲得した商談獲得金額 (LTR) (1ドル120円で作成)



商談獲得金額は、当該商談を獲得した後に生じる事後的な状況の変化を反映して更新しておりません。こうした事後的な状況の変化には、(1) 実際の売上、開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティなどの要因の変動、ならびに (2) 商談獲得後の案件の中止が含まれます。獲得済みの商談について、将来、案件がキャンセルされる可能性もあります。これら商談獲得後の事後的な状況の変化による影響は、商談獲得残高に反映されます。商談獲得残高とは、特定の時点において存続している案件に係る商談獲得金額の残存額についての、当該時点における当社の見積りを表すものです。上述の (1) および (2) を含む事後的な状況の変化による影響は、商談獲得残高に反映されます。FY19からFY25までの商談獲得金額の合計について、およそ15%に相当する商談が事後的に中止となっています。これまでのところ、これらの案件のキャンセルによる影響は他の獲得済商談における単価上昇や生産数量の増加などの影響で一部オフセットされ、結果的に、商談獲得金額の合計に対する影響は数%の減少となっています。詳細については、本資料3ページをご参照ください。

Copyright 2026 Socionext Inc.

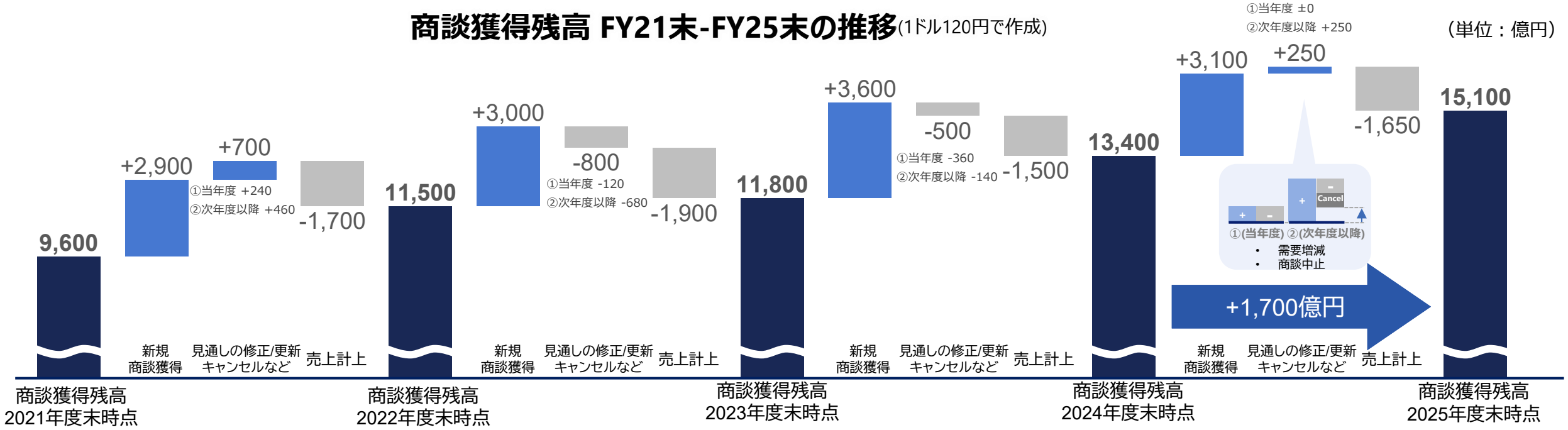
商談獲得残高の変動内訳

2026年4月決算説明会
掲載資料

- FY25の新規商談獲得が前年を下回り、また、一部商談のキャンセルがあったものの、獲得済商談の残高の増加により、商談獲得残高は+1,700億円増加し、約1兆5,100億円(1ドル120円で計算)に
- FY25末残高の約60%が、今後4年間に売上計上され、今後数年の売上増につながると期待

商談獲得残高 FY21末-FY25末の推移(1ドル120円で作成)

（単位：億円）



商談獲得金額は、当該商談を獲得した後に生じる事後的な状況の変化を反映して更新しておりません。こうした事後的な状況の変化には、(1) 実際の売上、開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティなどの要因の変動、ならびに (2) 商談獲得後の案件の中止が含まれます。獲得済みの商談について、将来、案件がキャンセルされる可能性もあります。これら商談獲得後の事後的な状況の変化による影響は、商談獲得残高に反映されます。商談獲得残高とは、特定の時点において存続している案件に係る商談獲得金額の残存額についての、当該時点における当社の見積りを表すものです。上述の (1) および (2) を含む事後的な状況の変化による影響は、商談獲得残高に反映されます。FY19からFY25までの商談獲得金額の合計について、およそ15%に相当する商談が事後的に中止となっています。これまでのところ、これらの案件のキャンセルによる影響は他の獲得済商談における単価上昇や生産数量の増加などの影響で一部オフセットされ、結果的に、商談獲得金額の合計に対する影響は数%の減少となっています。詳細については、本資料3ページをご参照ください。

Copyright 2026 Socionext Inc.

商談獲得残高　アプリケーション別及び地域別

2026年4月決算説明会
掲載資料

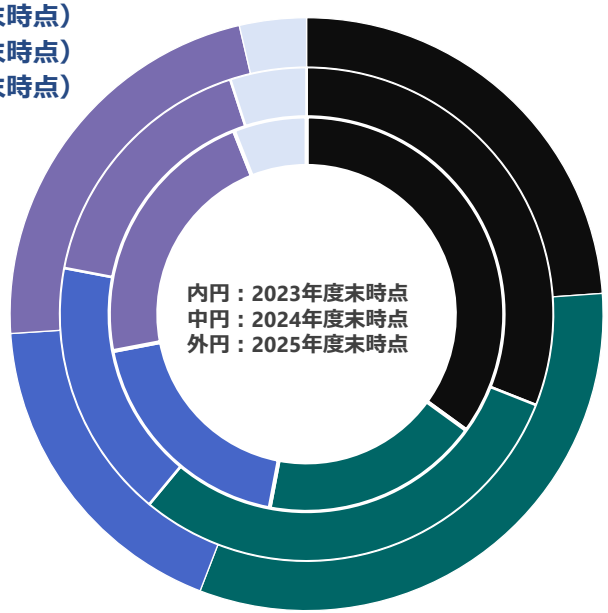
- アプリケーション別について
  - 2025年度はデータセンター/ネットワーク、インダストリアル分野などの商談獲得残高比率が増加
  - 中長期的には、オートモーティブ、データセンター/ネットワーク、その他分野(インダストリアルなど)でバランスの取れた構成を目指す
- 地域別について
  - 2025年度は米国・日本のシェアが若干増加したが、米国、中国を含むその他地域、日本の各地域でバランスの取れた構成を維持

アプリケーション別

商談獲得残高

11,800億（2023年度末時点）
13,400億（2024年度末時点）
15,100億（2025年度末時点）

- オートモーティブ
- データセンター/ネットワーク
- スマートデバイス
- インダストリアル
- その他



地域別[1]

- 米国
- 中国
- 欧州・アジア(中国・日本除く)
- 日本

1. 商談獲得残高における地域別は当社地域会社別ベースとなっています。

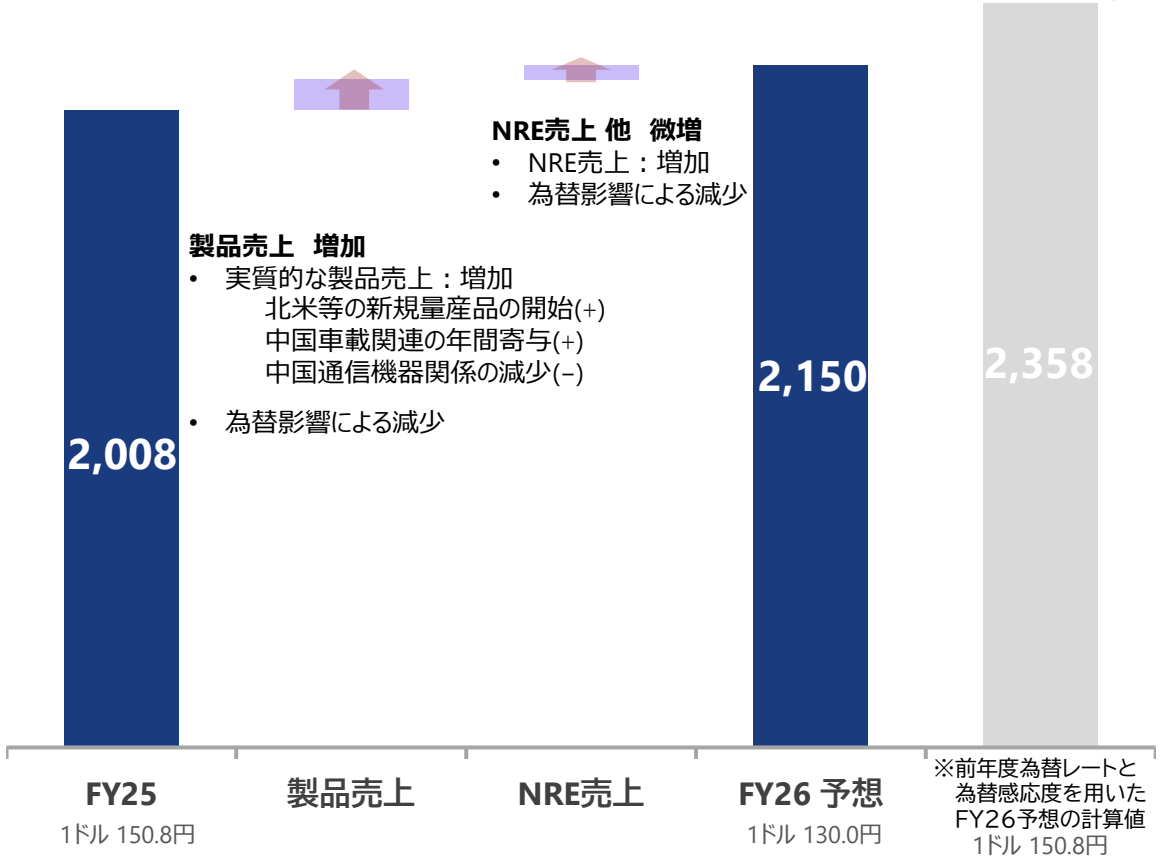
Copyright 2026 Socionext Inc.

2026年度 通期予想（2025年度実績比）

2026年4月決算説明会
掲載資料

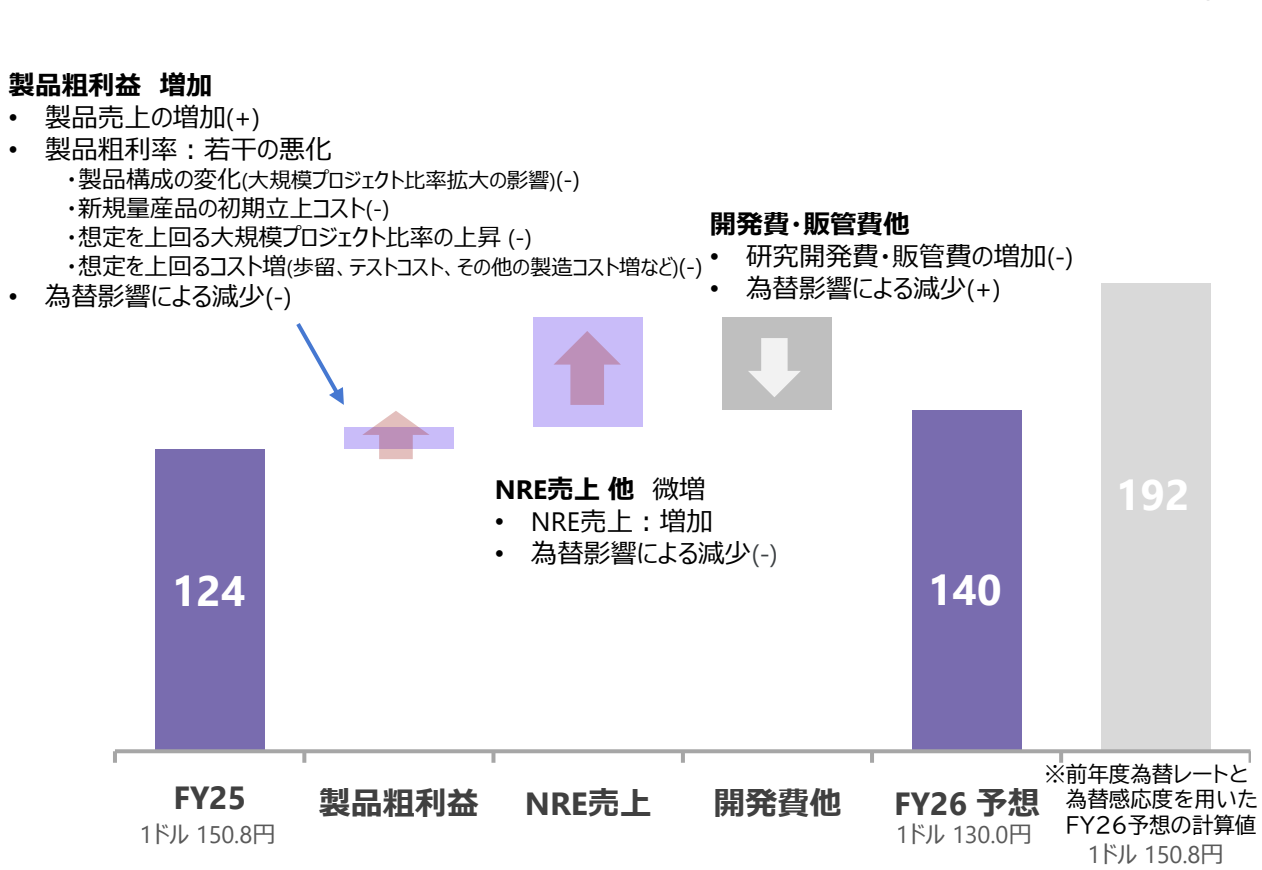
売上高（2025年度実績比）

（単位：億円）



営業利益（2025年度実績比）

（単位：億円）



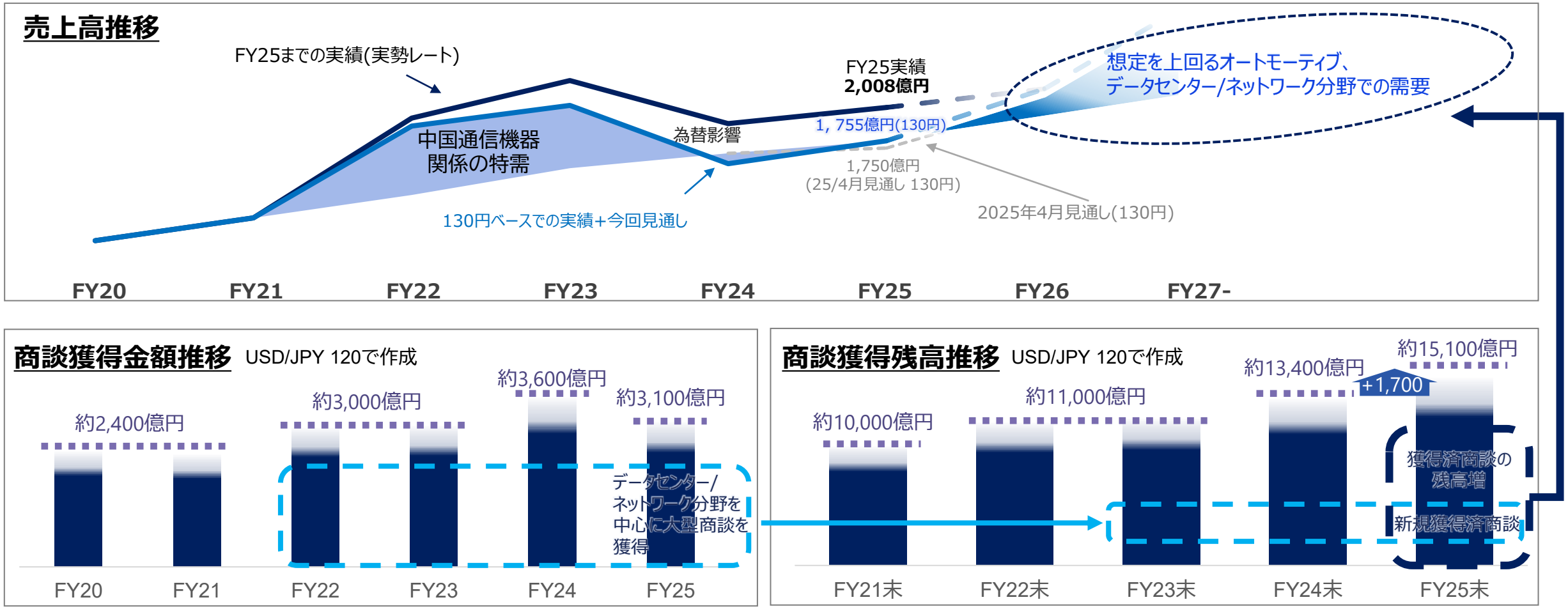
➢ 2026年度予想における為替感応度は、ドルに対して1円の変動で、売上高約10億円、営業利益約2.5億円と想定しています。
他の通貨についての影響は軽微と想定しています。

Copyright 2026 Socionext Inc.

これまでと今後の売上高の推移

2026年4月決算説明会
掲載資料

- 2025年度後半から売上成長軌道へ、Medium-Term Targetsの策定時の想定を上回る成長を期待
- 2026年度は策定時の想定を（同一為替レートで）若干上回る見込み
- 商談獲得金額は前年度を下回ったものの、商談獲得残高は獲得済商談の残高増により、約15,100億円に増加(対前年度末+1,700億円)。



Copyright 2026 Socionext Inc.

製品粗利・開発費比率の推移と今後の見通し

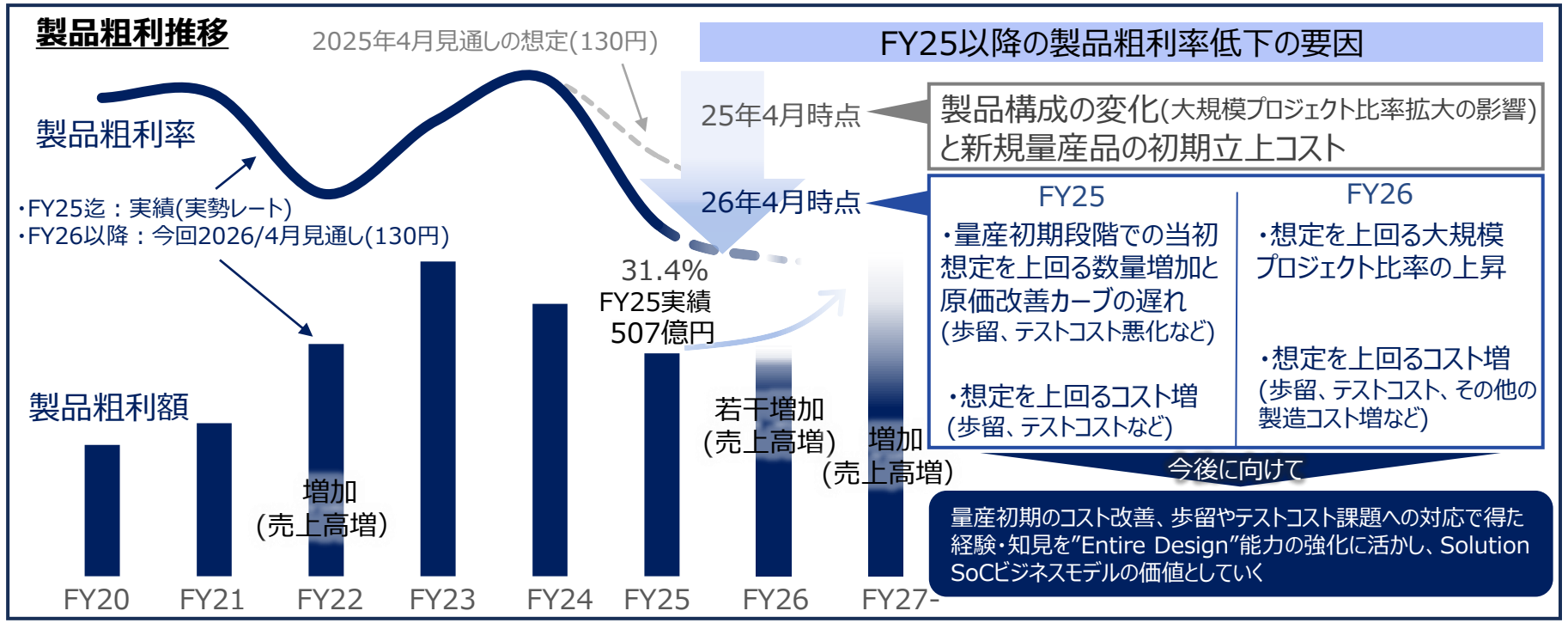
2026年4月決算説明会
掲載資料

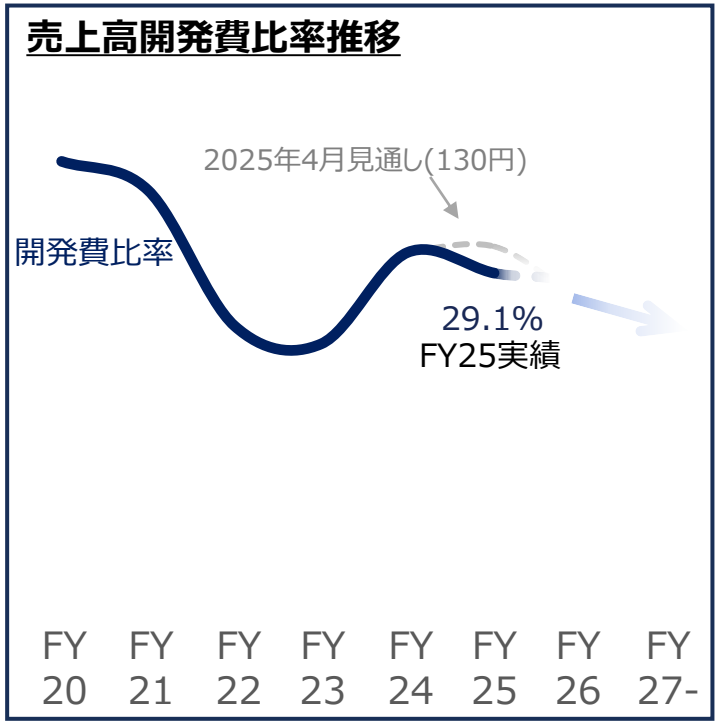
製品粗利推移

- 2025年度の製品粗利率は、大規模プロジェクトにおける量産初期段階での当初想定を上回る数量増加と原価改善カーブの遅れ、想定を上回るコスト増により、2025年4月見通しに対しさらに数%低下（年度当初から、製品構成変化(大規模プロジェクト比率拡大)と新規量産品の初期立上コストで一定の悪化を織り込んでいたが、その水準からさらに数%低下）
- 2026年度製品粗利率は、2025年度から若干の悪化を見込む
（続く先端新規量産品の立上、想定を上回る大規模プロジェクト比率の上昇、歩留、テストコスト増、その他の製造コスト増などの要因を織り込む）
- 2027年度以降も製品粗利率はこの水準が続く可能性があるが、売上増でオフセットされていき、製品粗利額については、従来見通しの水準となることを期待

売上高開発費比率推移

- 引き続き先端分野への積極的な投資を行なうが、売上高増加によるレバレッジ効果で、売上高開発費比率は低下していく見通し



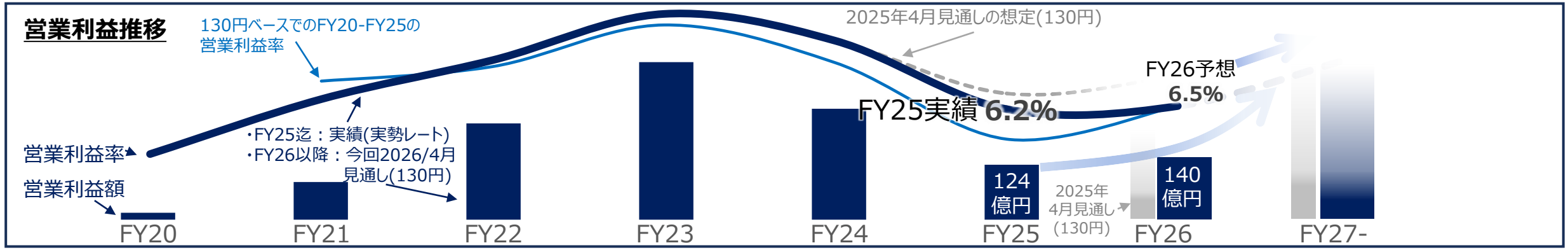


Copyright 2026 Socionext Inc.

営業利益の推移と今後の見通し

2026年4月決算説明会
掲載資料

- 2025年度：製品粗利率低下等により、営業利益額、営業利益率ともに2025年4月見通しの想定を下回る
- 2026年度：製品粗利率は前年度を若干下回る水準となり、また、引き続き先端分野への積極的な開発投資を行なうが、売上増による製品粗利額増が一定程度オフセットし、対前年で増益を予想（しかし、営業利益額、営業利益率ともに2025年4月見通しの想定を下回る）
- 2027年度以降：製品粗利率はMedium-Term Targets策定時の想定を下回るが、売上高拡大でオフセットし営業利益額が増加すること、また、そのレバレッジ効果による営業利益率改善に期待



	～22年度	23年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度～
製品粗利率	■ (−)製品構成の変化	■ (+)調達に係る間接的な為替影響による改善	■ (+)製品構成の変化 ■ (+)調達に係る間接的な為替影響による改善	■ (−)製品構成の変化と(−)新規量産品の初期立上げコスト ■ (−)量産初期段階での当初想定を上回る数量増加と(−)原価改善カーブの遅れ ■ (−)想定を上回るコスト増	■ (+/−)製品構成の変化と(−)新規量産品の初期立上げコスト ■ (−)想定を上回る大規模プロジェクト比率の上昇 ■ (−)想定を上回るコスト増	■ (+/−)製品構成の変化 ■ (+)量産後の原価率改善及び(−)新規量産品の初期立上
(粗利額)	(売上高増加でオフセットし増加)			(粗利率低下で減少)	(売上高増加も粗利率低下のオフセットは限定的)	(売上高増加で粗利率低下はほぼオフセットし増加)
研究開発費比率	■ (+)売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善		■ (−)開発体制強化に加え、先行開発により費用増	■ (−)先行技術への投資による費用増加 ■ (+)売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善	■ (−)先行技術への投資による費用増加 ■ (+)売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善	■ (−)先行技術への投資による費用増加 ■ (+)売上高の拡大に伴う研究開発費比率の改善
販管費比率	■ (+)売上高の拡大に伴う販管費比率の改善		■ (−)販管費は減少するも売上高減により販管費比率増	■ (+)売上高の拡大に伴う販管費比率の改善	■ (+)売上高の拡大に伴う販管費比率の改善 ■ (−)積極的なIT投資	■ (+)売上高の拡大に伴う販管費比率の改善 ■ (−)積極的なIT投資
為替	135.5	144.6	152.6	150.8	130.0	130.0

利益悪化
利益改善

表中の矢印及び +/- は営業利益率への影響を示しています。

socionext

Copyright 2026 Socionext Inc.

Medium-Term Targetsの進捗状況

2026年4月決算説明会
掲載資料

Medium-Term Targets（2025年4月策定）

	2024年度 実績	2025年度 実績(更新)	Medium-Term Targets[2]	進捗状況
売上高成長率	1,885億円 1ドル152.6円 （1,700億円[1] (1ドル130円)）	2,008億円 1ドル150.8円 （1,755億円[1](1ドル130円)）	年平均成長率 10%台半ば	策定時の想定を上回る成長を期待
営業利益率 （営業利益）	13.3% （250億円）1ドル152.6円	6.2% （124億円）1ドル150.8円	10%台半ば から後半	製品粗利率は策定時の想定を下回っているが、売上高拡大がこれをオフセットし営業利益額が増加していくこと、また、そのレバレッジ効果による営業利益率の改善に期待

1. Medium-Term Targetsと対比するための概算値です。 2. 為替影響を除いた実質での成長目標です（1ドル130円を前提に作成しています）。

ご参考

中期事業目標(2022年9月公表)

	2020年度	2021年度	中期目標
売上高成長率	997億円	1,170億円	年平均成長率 10%台後半
営業利益率	1.6%	7.2%	10%台前半 ～半ば

実績

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度 (追加)
売上高	997	1,170	1,928	2,212	1,885	2,008
為替レート(USD/JPY)	106.1	112.4	135.5	144.6	152.6	150.8
営業利益率	1.6%	7.2%	11.3%	16.1%	13.3%	6.2%

socionext

Copyright 2026 Socionext Inc.

市場トレンドと2026年度業績予想の背景及び2027年度以降の見通し

2026年4月決算説明会
掲載資料

市場トレンドと商談獲得

オートモーティブ

- AD/ADAS関連の技術、サービスのイノベーションが継続する中、AIの導入により大きな変革を迎える
- 電力の最適化、高機能を実現するSolution SoCビジネスモデルへの需要が高まる
- サービス指向企業、新興OEMとの次世代製品に加え、既存大手OEMビジネスに期待

データセンター/ネットワーク

- 生成AIに加え、エージェンティックAIの需要も高まり、データセンター/ネットワーク向けのSoC需要が拡大
- 様々なIPとプロセッサー(CPU/xPU)の統合が求められる
- 電力の最適化、高機能を実現するSolution SoCビジネスモデルへの需要が高まる
- 最先端技術(2nm/1.4nm、Chiplet、3D/5.5D、Co-Packaged Opticsなど)の採用ニーズが高まる

インダストリアル/スマートデバイス（フィジカルAI）

- AIやネットワークの活用拡大により、産業用途で先端技術を使用したSolution SoCビジネスモデルへの需要の拡大に期待
- 様々なIPとxPUの統合が必要なフィジカルAI分野が長期的な大きな成長機会に

商談獲得の動向:

AIをはじめ、新たなサービス・アプリケーションの登場、SoC設計の複雑化、SoCエコシステムの進化を背景に、カスタムSoCの需要が拡大

- 引き続き、上記領域での大型案件の獲得と、中長期の成長を支える水準の商談獲得金額の達成を目指す

2026年度予想

売上高はMedium-Term Targets策定時の想定を若干上回る見込み。営業利益は、製品粗利率が前年度を若干下回る水準となり、また、先端分野への積極的な開発投資を行なうが、売上増による製品粗利額増が一定程度オフセットし、対前年で増益を予想

■ 製品売上

- 2025年度第2四半期からの中国車載向け新規量産品が年間で販売に寄与
- 北米車載・北米データセンター向けを含む複数の製品の新規量産も始まる

■ NRE売上

- 獲得済商談の開発進捗に伴うNRE売上に加え、注力分野での新規商談獲得に取り組み、前年度からの増加を予想

■ 営業利益

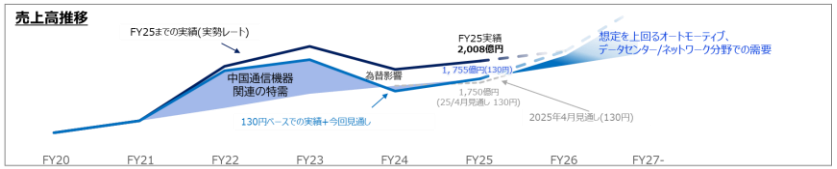
- 製品粗利率：製品構成の変化(大規模プロジェクト比率拡大の影響)と新規量産品の初期立上げコストによる影響を想定していたものの、想定を上回る大規模プロジェクト比率の上昇と、想定を上回るコスト増(歩留、テストコスト、その他の製造コスト増など)により、2025年度から若干の悪化を見込む
- 研究開発費比率：積極的な先行投資を継続するものの、売上高増加に伴うレバレッジ効果により、前年度の水準から低下
- 販売費及び一般管理費比率：売上高増加に伴うレバレッジ効果により、前年度の水準から低下
- 営業利益率：売上増が製品粗利率の悪化を一定程度オフセットし、対前年での改善を予想

<為替レート前提>

- 為替レート　：年間平均 1ドル＝130円
- 為替感応度　：ドルに対して1円の変動で売上高 約10億円
  営業利益 約2.5億円を想定

2027年度以降（見通し）

売上高はMedium-Term Targets策定時の想定を上回る成長を期待。営業利益は、製品粗利率が策定時の想定を下回っているが、売上高拡大がこれをオフセットし営業利益額が増加していくこと、また、そのレバレッジ効果による営業利益率の改善に期待



■ 製品売上

- 車載向け、データセンター向けを含む複数の大型製品の販売寄与により、継続的な成長を見込む

■ NRE売上

- 継続的に緩やかな増加を見込む

■ 営業利益

- 製品粗利率は策定時の想定を下回るものの、売上高拡大がこれをオフセットし、営業利益額が増加していくこと、また、そのレバレッジ効果による営業利益率の改善に期待

■ 更なる成長に向けた先端技術分野への積極的な投資

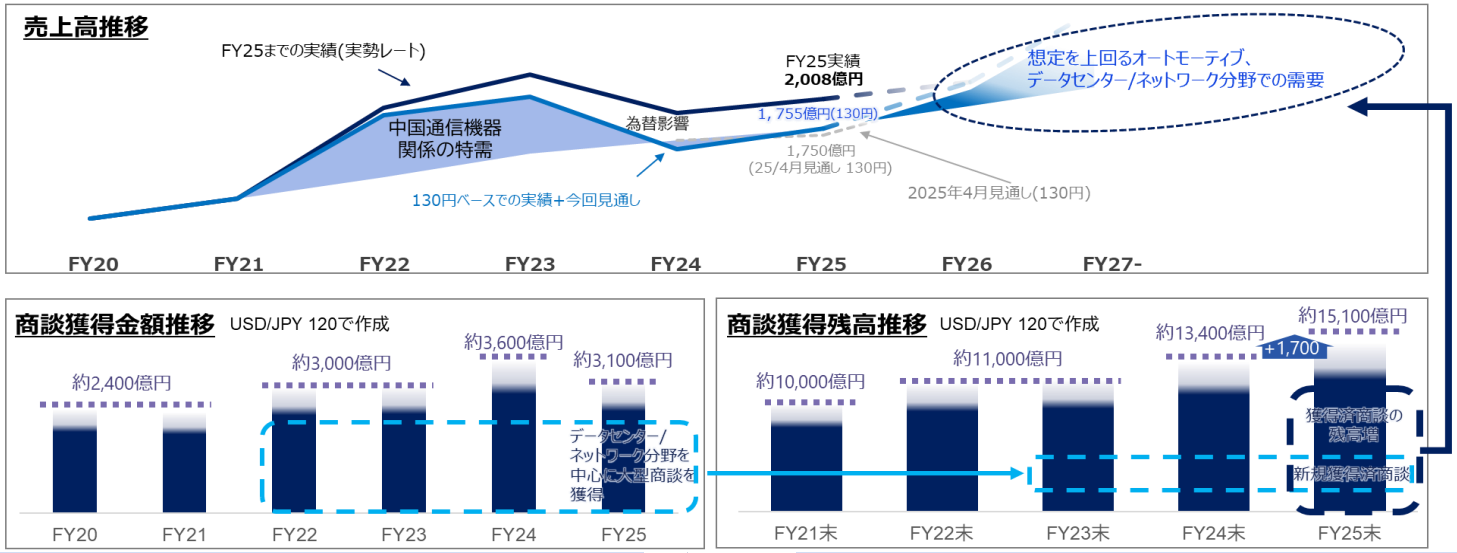
■ 成長重視の経営を加速

Copyright 2026 Socionext Inc.

今後の成長経路

2026年4月決算説明会
掲載資料

- 「第一の変革」(ビジネスモデルおよび事業分野の転換)により達成された商談獲得残高を基盤に、継続的な売上成長(これまでの想定を上回る売上成長に期待)と製品粗利・営業利益の拡大を目指す
- これまでの先端分野での大型開発の実績を通じて、開発体制・技術力の強化が進む
  今後さらに「第二の変革」で、開発体制の再編強化、先端技術への投資、経営体制の強化/グローバル化に取り組み、商談獲得の拡大、そしてさらなる成長と発展へ



更なる成長に向けた成長戦略(第二の変革)

- ✓ 開発体制の再編強化
- ✓ 先端技術への投資
- ✓ 経営体制の強化、グローバル化

「第一の成長」に繋がった「第一の変革」(ビジネスモデル・事業分野転換)に続く「第二の変革」に取り組む

継続的な売上成長

及び

粗利額・営業利益額の拡大
営業利益率の改善

Copyright 2026 Socionext Inc.

半導体市場のトレンドとカスタムSoC／Solution SoCビジネスモデルの要求拡大の背景

2026年4月決算説明会
掲載資料

AI技術とSoC技術の進化のスパイラルが市場拡大を加速

新しいサービスやアプリケーションの登場

SoC技術の進化にともないAIの活用が拡大

技術の進化により新たなサービスやアプリケーションが生まれ、それらに合わせて最適化されたSoCを要求

SoCエコシステムの進化

垂直統合が進む一方、SoCエコシステムのオープン化も進展、より機能的なIPやChipletオプションが利用可能に

CPUコアだけではなくGPU、NPUやAI処理に特化したプロセッサーなど、プロセッサーの多様化（xPU）

さらに、プロセッサーの多様化とともにIPサブシステムとオープンソースソフトウェア (OSS) の可用性が拡大

3D/5.5DとChipletの時代へ

フルカスタムSoCから“de-integration”の流れによるChiplet（プロセッサーChiplet、メモリーChiplet、IO Chipletなど）、高密度パッケージング、次世代プロセスノード (2nm/1.4nm)への急速な進展

さらなる設計の複雑さとともに、これまでのSoCの歩留、検証、評価、解析、DFTだけでなく、レチクルサイズや電力/熱密度、電気信号での高速化などの物理限界など、新たな課題が顕在化

複雑化する設計 = “Entire Design（全体設計）”

アーキテクチャー、サーマルマネジメントやシステムレベルでのテスト、検証などを統合した”Entire Design（全体設計）”アプローチは、システム全体のPPAの効率を最大化するために、データセンターや自動車などの先進的な分野で不可欠

ChipletやCPO(Co-packaged optics）のような新しいテクノロジーの複雑さが”Solution SoC”ビジネスモデルの有効性を拡大

Bespoke vs ASSP

More than Mooreの時代には、革新的な顧客は独自のPPA目標を満たすカスタムSoCを要求、ベンダーロックインを避けるためにASSPから離れる傾向も

AIの急速な進化は、新たなテクノロジーの採用や複雑さを増すカスタムSoCへの移行を加速

様々なアプリケーション市場（CloudからPhysical AIへ）でのSolution SoCビジネスモデルへの新たなニーズ

先進的な次世代製品・サービスに必要なIPとプロセッサーを統合するために、顧客は最適化され高度な機能を実現する“Solution SoC”ビジネスモデルを採用

AIの進展が、Cloudから自動車やロボットなどの新しい分野（Physical AI）に拡大することで、カスタム（Bespoke） SoCの需要が拡大

Copyright 2026 Socionext Inc.

今後の成長に向けた取り組み　先端技術への投資（積極的な先行開発投資）

2026年4月決算説明会
掲載資料

AIを活用した新たなサービスやアプリケーションの登場と幅広い分野に広がる半導体エコシステムの進化

→ 革新的な顧客は、先端SoC開発のために「Entire Design（全体設計）」能力があるパートナーを求めている

→ 「Entire Design（全体設計）」や「コンプリートサービス」を実現するための先行投資が必要

＜ 市場動向と要求＞

新しいサービスとアプリケーション

テクノロジーの進化により新たなサービスやアプリケーションが生まれる
AIを活用したサービスやアプリケーションの拡大により、最適化されたSoCの需要が拡大

設計の複雑さ / Entire Design

設計の複雑さが増すことにより「Entire Design （全体設計）」における難易度も高まり、システムファンクション、サーマルマネージメント、組立、テストなどの要素を網羅するアーキテクチャーおよびシステム設計がますます重要になっている＝データセンターや自動車など、高度な技術を必要とする分野で「Entire Design（全体設計）」の重要性が高まっている

- More than Moore
  PPAが過去のレートで改善しなくなった「More than Moore」時代のASSPのパフォーマンスに対する不満とロックインの懸念
- 3DとChiplet
  Chipletの進化（ホモジニアス→ヘテロジニアス）、先端パッケージング技術、高速インターフェース技術、プロセスノードの進化が続く（2nm/1.8nm/1.4nm）
- SoCエコシステムの革新
  ChipletはSoCの設計と開発をより効率的にする一方、より複雑に

設計プロセスの効率化と設計品質

AI導入による設計プロセスの効率化

効率化のための検証・テスト技術の進化

<「Entire Design（全体設計）」や「コンプリートサービス」を実現するための先行投資>

先端テクノロジー

光データ伝送、データセンターやHPCのような分野の新製品・新サービスで使用する先端技術を活用（パートナー・イノベーティブな顧客とのパートナーシップ強化）
- 最先端の高速インター―フェース（SerDes、PCIe、UCIeなど）
- CPO（Co-Packaged Optics）

2nm以細のテクノロジーノードとChiplet （3D/5.5D）

先端プロセスノードでの経験をベースに、グローバルSoCエコシステムパートナーとのパートナーシップによるChiplet技術と2nmや1.8nm、1.4nmの最先端プロセスノードを組み合わせた開発
高度なパッケージングテクノロジーの開発 ： 新しいDie-to-Die接続
- ウェハースケール統合パッケージング技術
- 3D/5.5D技術
- 新たなパッケージ/アセンブリ技術のための高信頼性解析技術
  （テスト、熱解析、On-die解析など）

SoC設計へのAIの活用

設計効率とPPAを実現するためEDA企業とも協力、
SoCの設計プロセスに積極的にAIを組み込む

半導体エコシステム企業とのパートナーシップ

グローバルSoCエコシステムパートナーとの協力関係の拡大・加速

Copyright 2026 Socionext Inc.

成長に向けた取り組み（先端技術分野での開発実績から）

2026年4月決算説明会
掲載資料

Smart Devices
(Edge Devices)

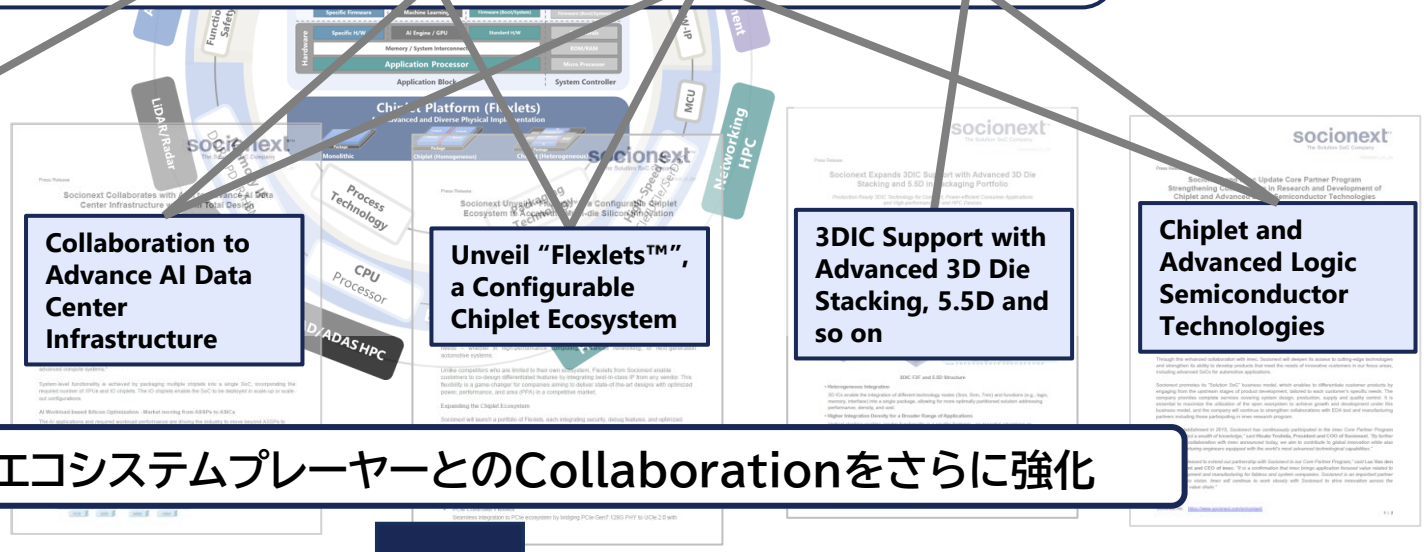
Physical AI

Industrial

これまでの先端技術分野での大型開発の実績
（多分野・多品種での開発実績を通じて設計・開発力の強化が進む）

Entire Design capability

- 自動車品質の設計能力
- 先端
プロセステクノロジー
- CPU/
CPUサブシステム/
xPU
- Flexlets
（Chiplet）
- 先端パッケージング
サーマル



- Continue to invest aggressively for advanced process node (2nm and beyond)
- Collaboration to Advance AI Data Center Infrastructure
- Unveil “Flexlets™”, a Configurable Chiplet Ecosystem
- 3DIC Support with Advanced 3D Die Stacking, 5.5D and so on
- Chiplet and Advanced Logic Semiconductor Technologies

グローバルエコシステムプレーヤーとのCollaborationをさらに強化

**開発体制の
継続的な再編・強化**

先端技術への投資

**経営体制の
強化・グローバル化**

Copyright 2026 Socionext Inc.

コンピューター・アーキテクチャー・ベースでのビジネス展開（アプリケーション市場別）

2026年4月決算説明会 掲載資料

Smart Devices (Edge Devices)

- AI活用の広がりもあり、新技術への需要は引き続き堅調

- ➢ “Solution SoC” ビジネスモデルを活用し、引き続き、DSC市場とともに、革新的な市場で必要とされるカスタム(Bespoke) SoCを提供
- ➢ これまでのISP開発のノウハウや設計品質の強みを活かし、コンピューター・ビジョン、ARなどのアプリケーションにおいて、先進的な顧客との商談は引き続き活発

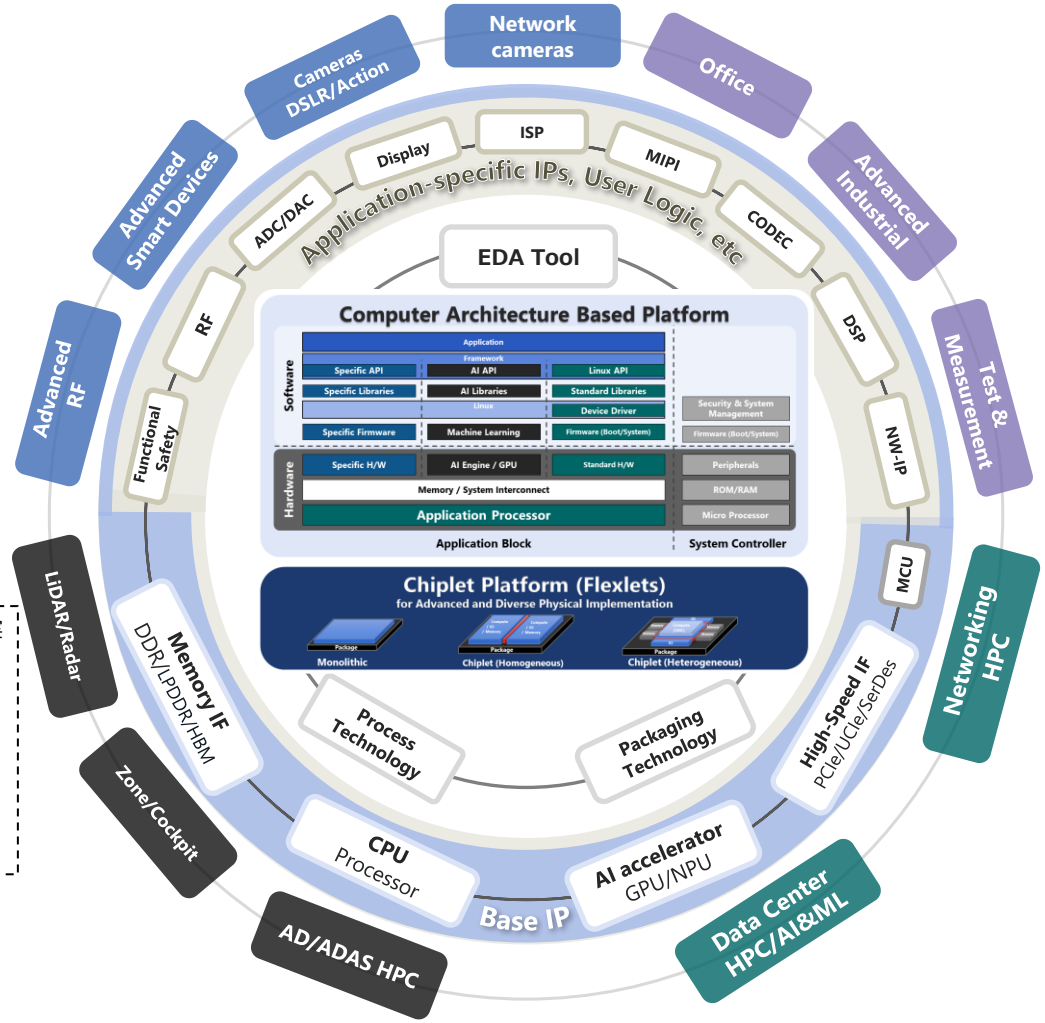
Automotive

- ADAS／AD(先進運転支援システム／自動運転)のイノベーションが継続
- AIの導入が重要な役割を果たすことで大きな変革を迎えている
- ゾーン・アーキテクチャーやセンシングSoCに加え、HPCの需要も旺盛
- サービス指向の企業や新たなOEM企業から次世代製品のさらなる商談機会が期待される
- 様々なIPとプロセッサー(CPU/xPU)の統合が必要

- ➢ 低消費電力、低遅延、および厳格な安全基準(ASIL-CおよびASIL-D) を実現する“Solution SoC”ビジネスモデル
  ＝“Solution SoC”ビジネスモデルで業界でのポジションを確立
- ➢ アーキテクチャーの提案、Fusa開発経験、自動車設計品質などを強みにお客様の次世代製品の商談は引き続き活発
- ➢ 現在、7nm 製品は量産中、5nm 製品はFY27/3から量産開始予定、3nm以細の新規商談も
- ➢ 最先端技術への投資を継続 (Chiplet, 3D/5.5D, 高速SerDes, Co-Packaged Optics, 2nm/1.8nm/1.4nm)

Physical AI

Physical AIの分野は、長期的に大きな成長機会
Automotive分野でのADAS開発の経験・実績を活かしたビジネス展開を



Industrial

- AIやネットワークの活用拡大により、産業用途で先端技術を使用した“Solution SoC”ビジネスモデルへの需要が拡大
- AIやCPUを強化し、アプリケーションIPや顧客の既存IPと統合した新たなSoCを開発する動き
- FAや計測機器向け大規模先端カスタムSoCなどのビジネスチャンスが拡大

- ➢ 設計品質の強みや顧客IPなど様々なIPを含めたEntire Design能力を活かし、“Solution SoC”ビジネスモデルで、先端プロセスノードを含む、様々なプロセステクノロジーを適用した“カスタム(Bespoke) SoC”を提供

Data Center & Networking

- 生成AIだけでなくエージェンティックAI需要の高まりによるデータセンター/ネットワークやクラウドサービス向けSoCの需要はますます成長拡大トレンド
- Scale-upとScale outの異なる2つの開発アプローチ
- 高速SerDesやCPO技術を使用する光データ伝送が要求される
- “Solution SoC”ビジネスモデルを採用する顧客が増加
- 様々なIPとプロセッサー(CPU/xPU)の統合が必要

- ➢ パフォーマンスと効率を追求するカスタムSoCの主要ターゲット市場
- ➢ CPU/xPU関連の開発経験と専門知識を有する数少ないカスタムベンダーとして“Solution SoC”ビジネスモデルでの事業拡大を目指す
- ➢ NANDインターフェースでの開発実績や最先端の技術・プロセスノードで「Entire Design(全体設計)」能力を強化、アーキテクチャーの提案力、パフォーマンス解析能力の強みを活かす
- ➢ 柔軟性のあるChipletプラットフォーム“Flexlets”を提供開始、IO Chipletの開発能力をさらに強化
- ➢ ハイパースケーラー向けCPU開発中、北米で複数のAI SoC商談を獲得
  これらの商談をテコにCPU、AI分野での事業を拡大するため、北米及びグローバルでの研究開発体制と開発力を強化
- ➢ 最先端分野でのIP企業との連携強化
- ➢ 最先端技術への投資を継続 (Chiplet, 3D/5.5D, 高速SerDes, Co-Packaged Optics, 2nm/1.8nm/1.4nm)

Copyright 2026 Socionext Inc.

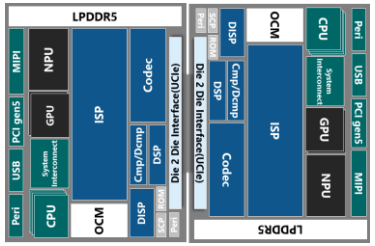
コンピューター・アーキテクチャー・ベースでの多様な分野での先端SoC開発事例

2026年4月決算説明会 掲載資料

- 主要アプリケーション間で、コンピューター・アーキテクチャー・ベースの似通ったシステム構成へ進む中、共通の開発プラットフォームを構築
- Chiplet、ヘテロジニアス・インテグレーション、サーマルマネジメント、信頼性など、設計の複雑化によるPPAの最適化の課題に対応

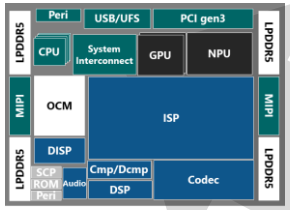
Smart Devices (Edge Devices)

Network Camera



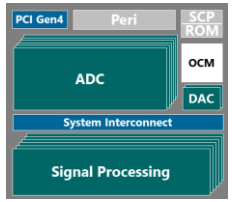
Chiplet / Homogeneous

Camera

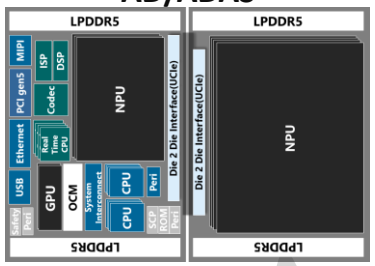


Automotive

LiDAR

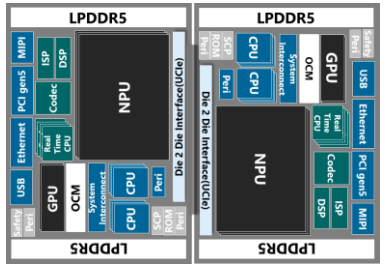


AD/ADAS

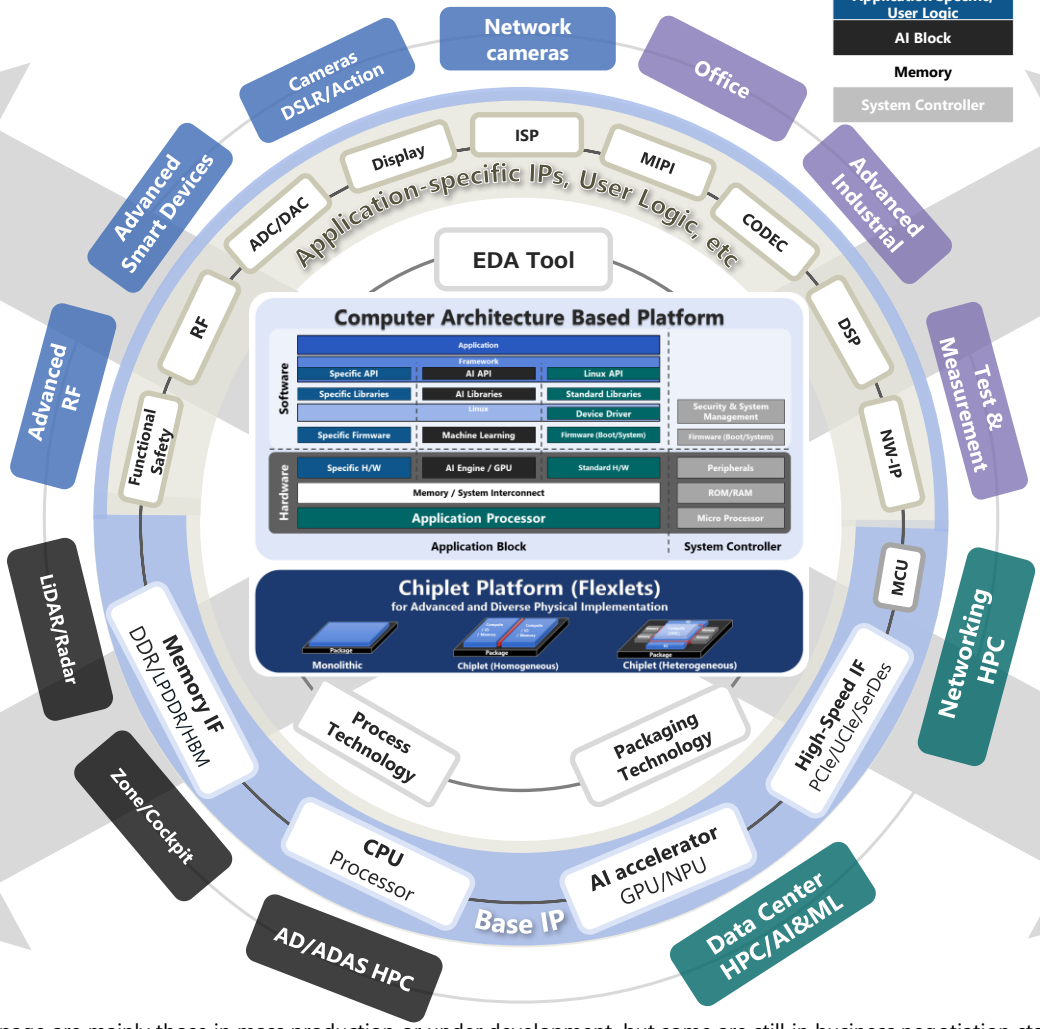


Chiplet / Heterogeneous

AD/ADAS

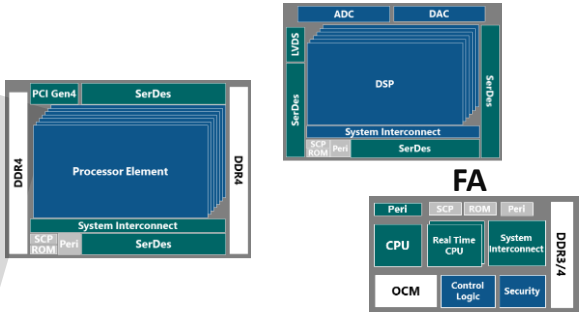


Chiplet / Homogeneous



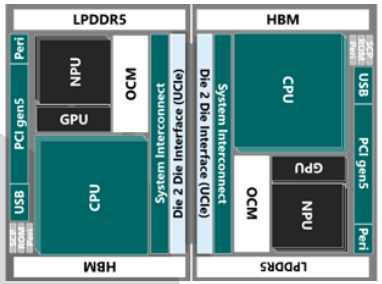
Industrial

Test & Measurement



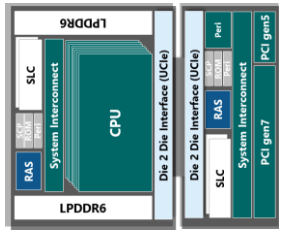
Data Center & Networking

Server Processor



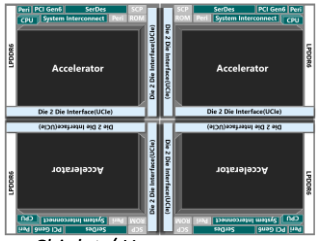
Chiplet / Homogeneous

Server Processor



Chiplet / Heterogeneous

AI Server Processor



Chiplet / Homogeneous

1.Development cases in this page are mainly those in mass production or under development, but some are still in business negotiation stage.

Copyright 2026 Socionext Inc.

各アプリケーション市場で拡大する商談獲得

2026年4月決算説明会
掲載資料

Smart Devices (Edge Devices)

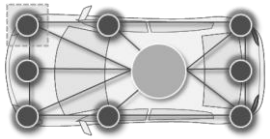
5/7/12nm
DSLR/Action

5/7nm
Network cameras
AR

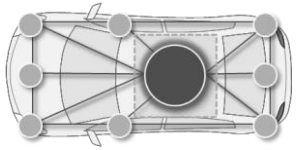
Automotive

16/22nm
LiDAR / Radar / Camera

7/16/22nm
Zone Computing

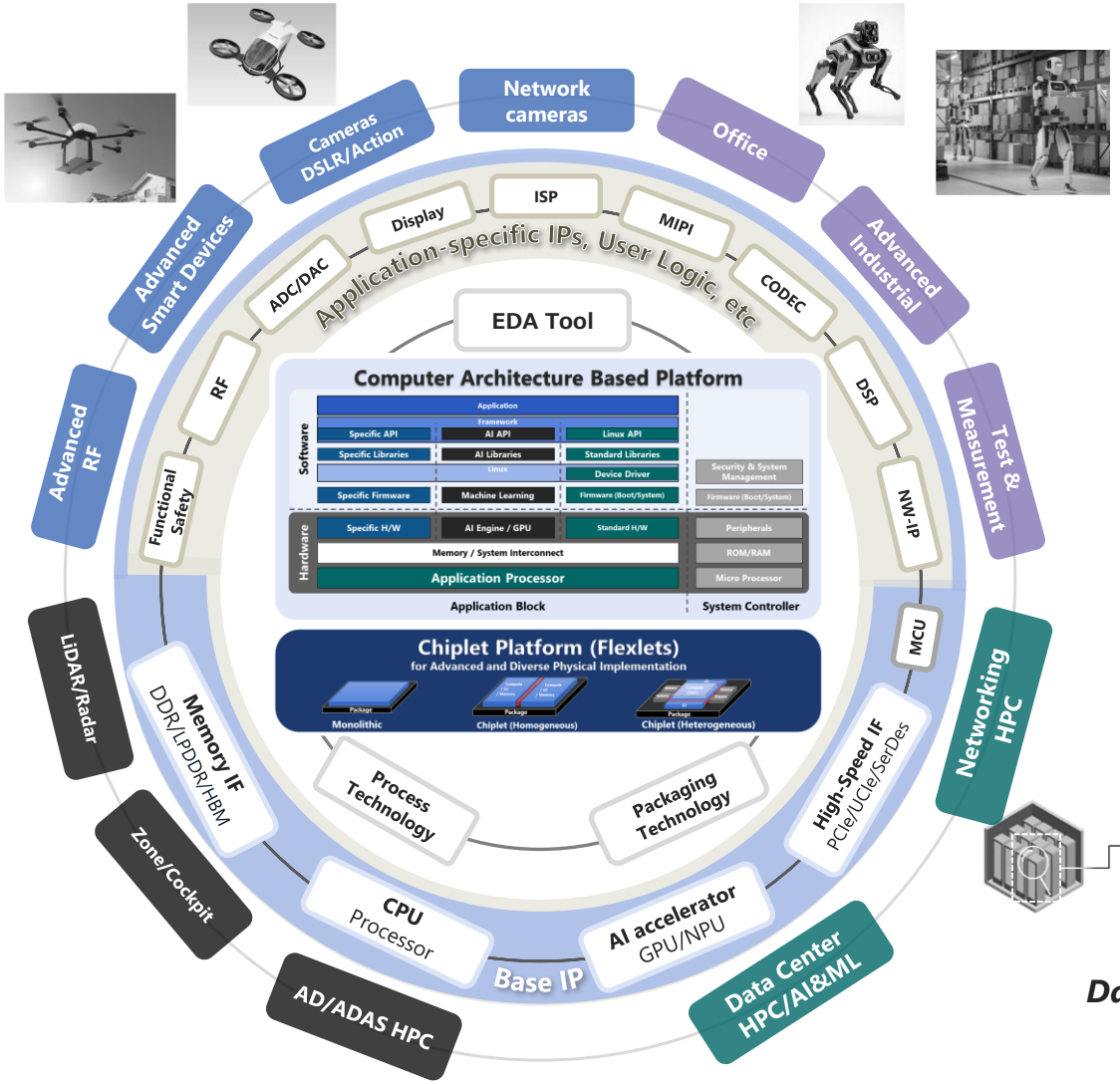


3/5/7nm
HP Computing



AD/ADAS HPC

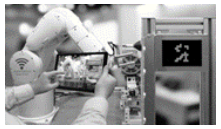
Physical AI



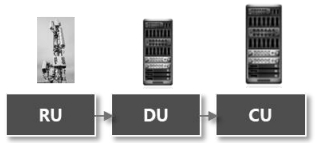
Industrial

3/5/7nm
Test & Measurement

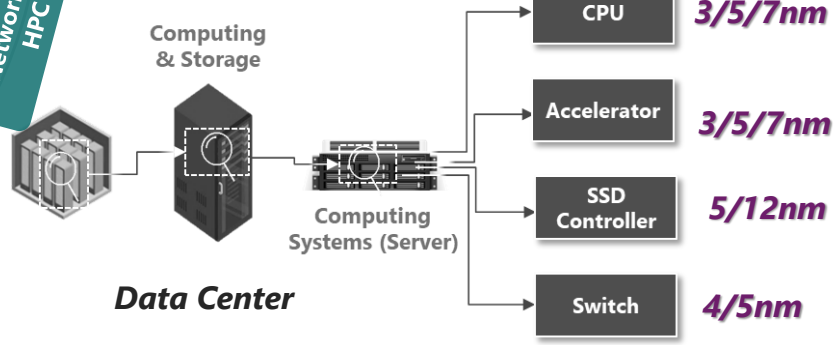
28nm
Printer



Data Center & Networking



7nm
Base Station



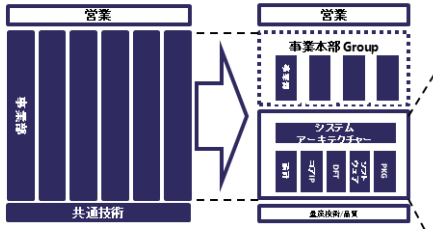
socionext

Copyright 2026 Socionext Inc.

開発体制の再編・強化（グローバル組織体制の抜本的な改革）

2026年4月決算説明会
掲載資料

～2018年3月　～ 2021年



BUの統合により、TVやカメラの事業領域から、
オートモーティブ、データセンター&ネットワーク、
スマートデバイスへと事業領域がシフト

2022年 ～

Leading Global R&D Team

システムアーキテクチャー
ソフトウェア, IP,
Chiplet, パッケージ
先端技術

プロジェクトマネジメント

開発リソース

- 「リーディング・グローバルR&Dチーム」の設置と強化（2022年以降）
- 日本の卓越したエンジニアリング力とシリコンバレーなどで培われた高度なイノベーション力とアーキテクチャ設計能力を融合

2025年4月～
Entire Designを担うグローバルリーディンググループを継続的に強化

グローバル組織体制の抜本的な改革

グローバル共同リード体制の構築
- 真のグローバル体制を構築（開発部門のグローバルco-lead体制）

“Entire Design”能力の強化
- 大規模最先端開発プロジェクトを複数同時に進めることができる能力を強化
- 先端技術への積極的な投資
- 幅広い機能をカバーする高いスキルを持つエンジニアチームを配置(SoCアーキテクチャー、CPUアーキテクチャー、Chiplet、RF、ミックスドシグナル、ソフトウェア, 検証, テスト, パッケージ, サーマルマネジメントなど)

グローバルな競争力のある開発体制の構築

グローバル開発体制の構築
- 高いスキルを持つエンジニアをグローバルに採用
- 日本とその他地域（主に米国）のエンジニアチームを統合

グローバルプロジェクトマネジメント体制を強化
- 海外地域会社のプロジェクトマネージャーと日本の連携強化

グローバルなリソースマネジメント体制の構築

リソースマネジメント (アウトソーシング含む)
- インドに新拠点を開設、米国現地法人主導のもと、社内外リソースを運用・強化

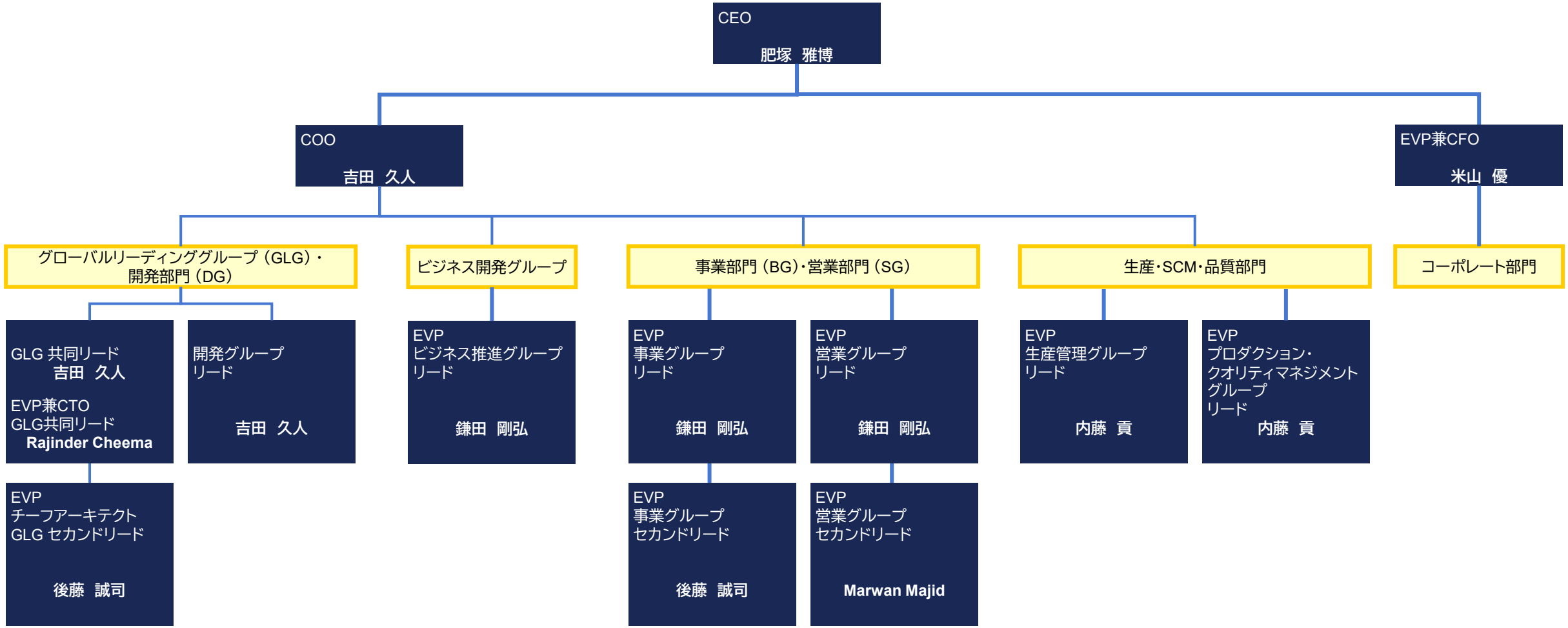
**Solution SoCビジネスモデルに沿った複数領域での
複数同時（並行）開発を可能とする体制の構築・強化**

Copyright 2026 Socionext Inc.

経営体制の強化・グローバル化

2026年4月決算説明会
掲載資料

2026年4月現在



- なお、EVPである斎藤正は開発グループ セカンドリード、安藤慎一はコーポレート部門 財務経理担当、中島弘雅はコーポレート部門 経営企画担当とし、林豊はPresident of Socionext Americaの業務を担当します。
- Global Technology Strategy Steering Membersを、CEO, COO, CTO, Chief Architectで構成します。

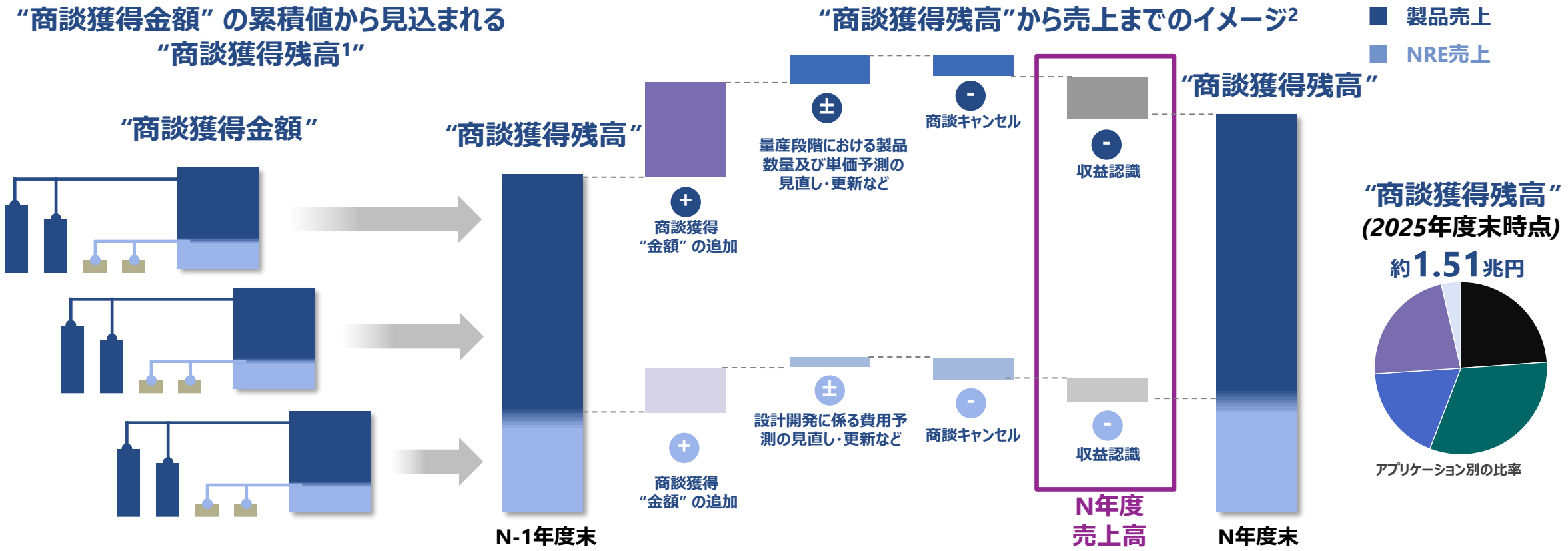
Copyright 2026 Socionext Inc.

商談獲得金額から売上までのイメージ
“商談獲得残高”とは

2026年4月決算説明会
掲載資料

“商談獲得残高”とは

“商談獲得残高” は、ある時点までに獲得され存続している商談の “商談獲得金額”の累積値から見込まれる顧客需要に関する当社の予測を示している。“商談獲得残高” は商談を獲得した期間の末から残高確認時点までの進捗又は変化を反映したものである。“商談獲得残高” は将来のリスクを都度反映するよう、保守的な方法で定期的に見直される



1.商談獲得金額は、当該商談を獲得した後に生じる事後的な状況の変化を反映して更新しておりません。こうした事後的な状況の変化には、(1) 実際の売上、開発計画、販売数量、製品単価、製造キャパシティなどの要因の変動、ならびに (2) 商談獲得後の案件の中止が含まれます。獲得済みの商談について、将来、案件がキャンセルされる可能性もあります。これら商談獲得後の事後的な状況の変化による影響は、商談獲得残高に反映されます。商談獲得残高とは、特定の時点において存続している案件に係る商談獲得金額の残存額についての、当該時点における当社の見積りを表すものです。上述の (1) および (2) を含む事後的な状況の変化による影響は、商談獲得残高に反映されます。FY19からFY25までの商談獲得金額の合計について、およそ15%に相当する商談が事後的に中止となっていますが、これらの案件のキャンセルによる影響は、他の獲得済商談における単価上昇や生産数量の増加などの影響で、商談獲得金額の合計に対して数%の減少となっています。
詳細については、本資料3ページをご参照ください。
2.説明目的の図となっています。

socionext

Copyright 2026 Socionext Inc.

商談獲得から量産までのイメージ
“商談獲得金額”とは

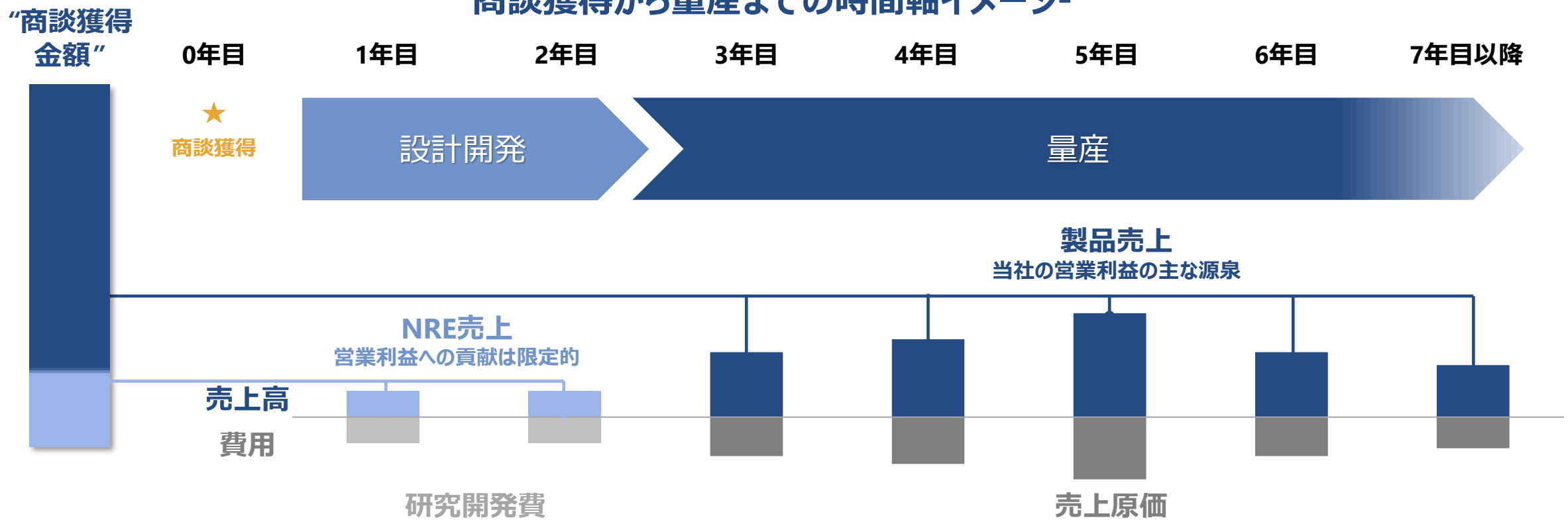
2026年4月決算説明会
掲載資料

“商談獲得金額”とは

“商談獲得金額”は、獲得した商談から見込まれる将来の顧客需要に関する当社の予測を示している。
“商談獲得金額”は*NRE*由来のものと製品由来のものに分けられる。“商談獲得金額”は、プロジェクトが量産段階に進むと製品売上に貢献する見込み
なお、当社は “商談獲得金額”を例えば以下のように保守的に算出している

- 顧客に提示された売上高予想ではなく、当社予測による製品単価や将来の製品の販売数量などの一定の前提に基づいて個別の “商談獲得金額”を予測[1]
- 想定為替レートは*1*ドル＝*120*円を使用

商談獲得から量産までの時間軸イメージ[2]



1. P.3をご参照下さい。
2. 説明目的の図であり、製品開発から量産までの実際のタイムラインは、製品や実際の顧客の需要によって大きく異なる場合もあります。

Copyright 2026 Socionext Inc.

先端領域におけるグローバルカスタムSoCベンダーへの転換

2026年4月決算説明会
掲載資料

- 事業及び企業文化の変革を通じ、新しい独自のビジネスモデル”Solution SoC”で業界をリードするグローバルなカスタムSoCベンダーに転換

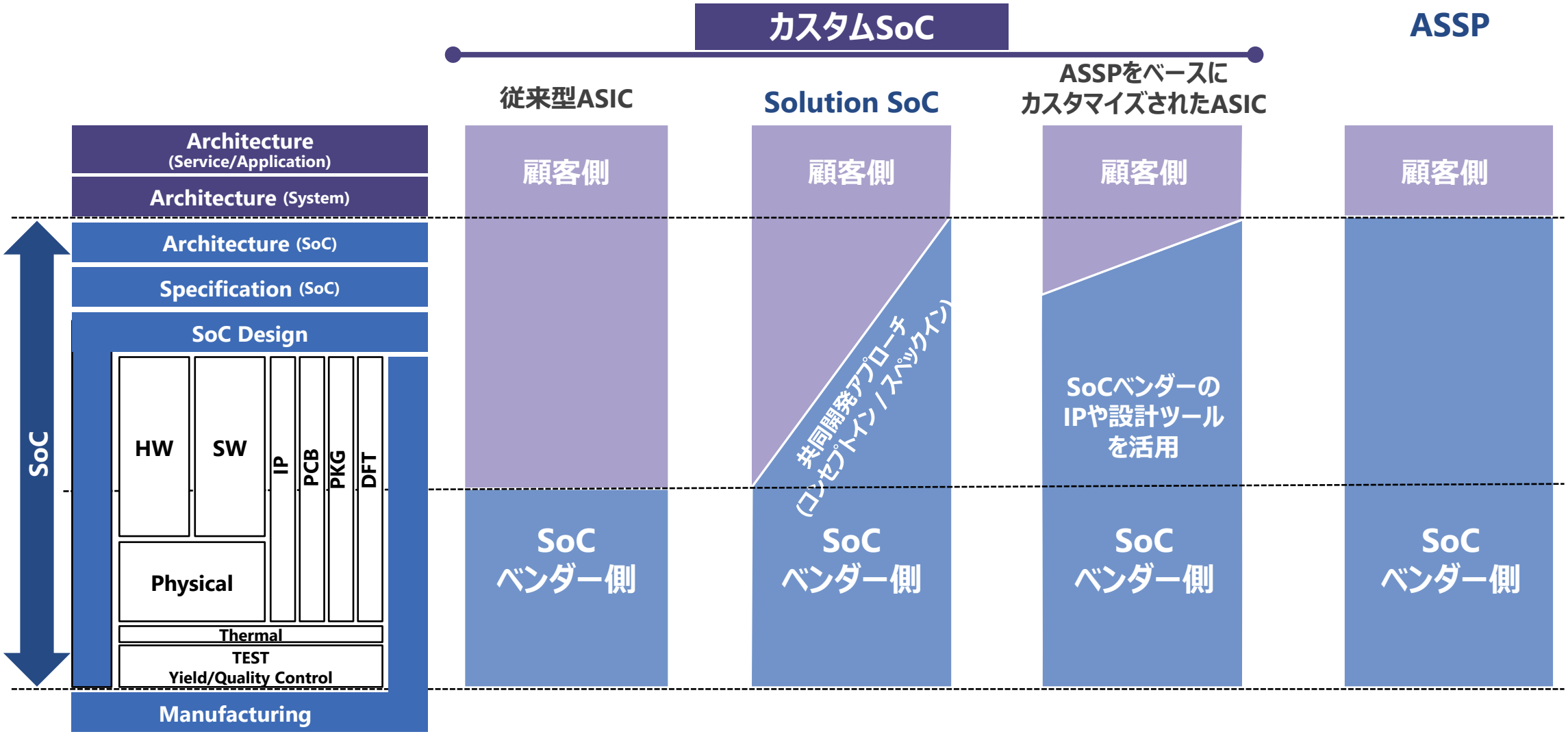
	ビジネスモデル転換	注力分野のシフト	海外事業の拡大	先端技術への対応	企業文化の変革
過去 2018	ASSP及びASIC に注力	DTV Blu-ray/DVD DSC 成熟市場	主に国内顧客	フォロワー	ピラミッド型組織
現在	カスタムSoC市場で Solution SoC に注力	オートモーティブ データセンター ／ネットワーク スマートデバイス 産業機器 成長市場	グローバル	リーダー *(2nm,3nm,チップレット)*	フラットな組織体制と 迅速な意思決定

Copyright 2026 Socionext Inc.

“Solution SoC”ビジネスモデルの特徴

2026年4月決算説明会
掲載資料

- 従来型ASIC とSolution SoCの主な違い：顧客とのインターフェース
- Solution SoCとASSPをベースにカスタマイズされたASICの主な違い：カスタマイズの幅



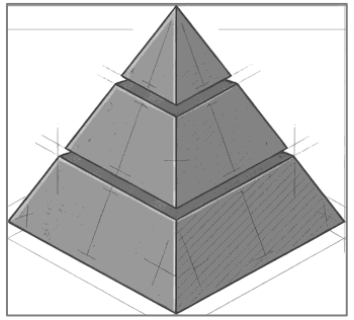
1. 本スライドは当社独自の認識を基に作成しています。

Copyright 2026 Socionext Inc.

（参考）Architecting the AI Silicon Era

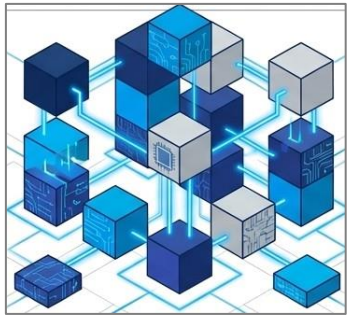
2026年4月決算説明会
掲載資料

The Collapse of the General-Purpose Pyramid



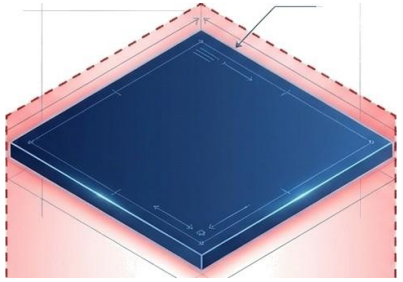
Standard ASSP (Legacy Approach)
- ✗ Vendor lock-in restricts innovation
- ✗ Bloated logic limits PPA* optimization
- ✗ Cannot meet specific AI enterprise workloads requirements

*power, performance, and area

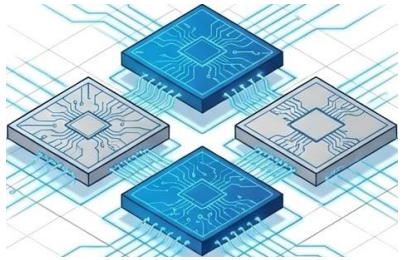


Custom SoC (The AI Mandate)
- ✓ Domain specific arch optimized for TCO & PPW
- ✓ True arch flexibility combining advanced chiplets
- ✓ Essential for real-time edge inference and massive data center models

Surmounting the Reticle Limit



← Physical Reticle Limit →



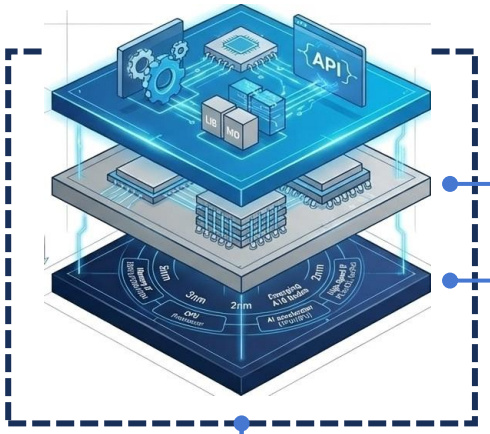
The Physical Wall:
Moore's Law–based scaling is over; data center AI chips exceed reticle size limits.

The Chiplet Imperative:
The industry must shift from monolithic dies to chiplets.

Economic Advantage:
Mixing process nodes boosts yields and cuts costs versus monolithic designs.

The "Entire Design" Moat

Beyond Silicon: The Hardware race is ultimately decided in software.
AI custom accelerators fail without software compatibility.



Advanced Packaging:
3D and 5.5D thermal management and signal integrity

Hardware Architecture:
Spec-to-silicon custom ASIC design across 5/3/2nm and emerging 1.8nm node and beyond

Verification & Quality

Global ecosystem partnership
flexible supply chain

socionext™

Copyright 2026 Socionext Inc.

今後の成長に向けた取り組み
（参考）先端技術分野における最近の活動 “Flexlets”

2026年4月決算説明会
掲載資料

Solution SoCビジネスモデルに沿ったEnd-to-Endのカスタム(Bespoke)SoC設計のために統合された柔軟性のあるChipletプラットフォーム

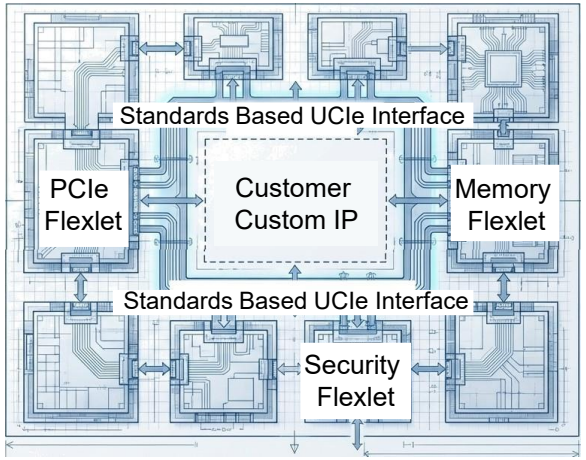
Flexlets: The Composable Silicon Platform

RTL-コンフィグラブル:
お客様のカスタムSoCを開発するために柔軟なChipletプラットフォーム

シームレスなインテグレーション:
IPやカスタムAIアクセラレータをSocionextインターフェイスでシームレスに統合

UCIe標準:
ユニバーサルChipletインターコネクトを活用したプラグアンドプレイのエコシステムの構築

PPAの最適化:
設計開始時から最適化されたPPAで最先端の設計を提供



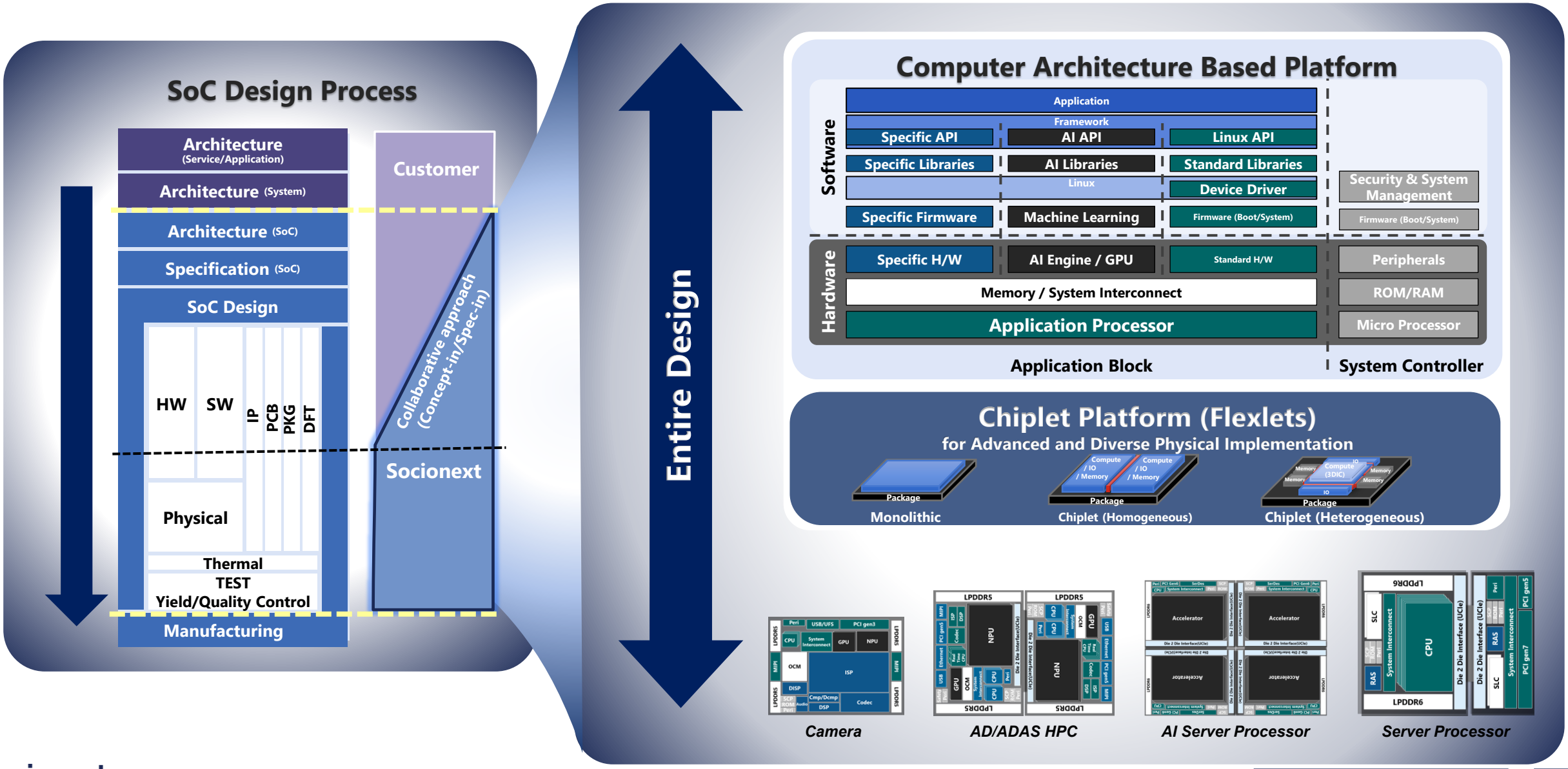
- 高性能コンピューティング、先進的なネットワーキング、次世代の自動車システムといった先進のアプリケーションにおいて、顧客のニーズに応じて性能を最適化できる柔軟性を提供
- 機能が固定されたハードウェアソリューションや自社のエコシステム内に限定されたクローズドなエコシステムの制約から解放し、あらゆるベンダーの最高水準のIPを活用・統合、差別化された機能を共同で設計できる環境を提供
- 「アーキテクチャーの真の柔軟性」、「シームレスなカスタムIP統合」、「最適な3rd Party IPを選択可能」、「設計初期からのPPA最適化」により「真に差別化された製品」を実現
- セキュリティ機能やデバッグ機能、最適化されたインターフェースを実装したFlexletsのラインアップを順次展開予定
- Flexletsラインアップにより、高性能で革新性的な次世代半導体に向けたスケーラブルなモジュール型設計基盤を提供

■ 昨年10月発表以来、すでに複数のFlexlets商談（IO Chiplet商談）を獲得、開発を開始

Copyright 2026 Socionext Inc.

(参考) Socionext's "Solution SoC" design & development platform

2026年4月決算説明会
掲載資料



Copyright 2026 Socionext Inc.

socionext™

The Solution SoC Company